

证券代码：002156

证券简称：通富微电

上市地点：深圳证券交易所



## 南通富士通微电子股份有限公司 重大资产购买预案

| 交易对方名称                       | 交易对方通讯地址  |
|------------------------------|---|
| Advanced Micro Devices, INC. | One AMD Place, P.O. Box 3453,<br>Sunnyvale, California 94088-3453 |

独立财务顾问



二〇一五年十月

## 董事会声明

一、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、与本次重大资产重组相关的审计、估值工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

三、本预案所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。

四、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责；投资者在评价公司本次交易时，除本预案及其摘要内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。

五、投资者在评价公司本次重大资产重组时，应认真考虑本预案内容、本预案同时披露的相关文件以及各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

## 交易对方声明

本次重大资产购买的交易对方已出具承诺：

“作为本次交易的对方，Advanced Micro Devices, Inc.（“卖方”）承诺在合理要求的范围内，并受限于相关的保密承诺为重大资产重组提供在重大方面真实、准确和完整的以下信息的副本：

截至交割日向买方提供的每一目标公司的账簿和其他记录在各重要方面均为完整和准确的，反映实际正当交易，并在各重要方面根据良好商业惯例保存。”

本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人将自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。

本次重大资产购买之标的公司的审计、估值工作尚未完成，本预案中涉及的标的公司相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、估值机构的审计、估值，本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、最终估值结论将在资产重组报告书中予以披露。

## 重大事项提示

本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。

### 一、本次重组方案主要内容

#### （一）本次交易方案概要

根据上市公司与 AMD 签订的《股权购买协议》，本次交易的标的为 AMD 位于中国的全资子公司 AMD 中国所持有 AMD 苏州 85%股权，以及 AMD 位于马来西亚的全资子公司 AMD 马来西亚所持有的 AMD 槟城 85%股权。

通富微电已就本次交易设立第一层收购平台通润达，产业基金等战略投资者拟以股权投资和（或）债权投资等方式作为共同投资人对通润达进行增资，通润达将以现金方式购买 AMD 苏州 85%股权。同时，通润达将在香港设立全资子公司 SPV (HK)，SPV (HK)将以现金方式购买 AMD 槟城 85%股权。

#### （二）交易对方

本次交易对方为 Advanced Micro Devices, Inc.，其与上市公司不存在关联关系。交易对方具体情况请详见本预案“第三节 交易对方基本情况”。

#### （三）战略投资者

本次交易的战略投资者拟包括国家集成电路产业投资基金股份有限公司，其基本情况如下：

|      |                    |
|------|--------------------|
| 企业名称 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 |
| 企业性质 | 股份有限公司（非上市）        |
| 成立日期 | 2014 年 9 月 26 日    |

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 注册地址  | 北京市市辖区经济技术开发区景园北街2号52幢7层718室 |
| 法定代表人 | 王占甫                          |
| 经营范围  | 股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询   |

截至本预案签署日，产业基金与通富微电不存在任何关联关系。

#### （四）交易标的

本次交易标的为 AMD 苏州以及 AMD 槟城各 85% 股权，AMD 苏州及 AMD 槟城具体情况请详见本预案“第四节 交易标的基本情况”。

#### （五）实施主体

本次交易中用于收购 AMD 苏州 85% 股权的实施主体为通润达，用于收购 AMD 槟城 85% 股权的实施主体为通润达的全资子公司 SPV (HK)。通润达的基本信息如下：

|       |  |
|-------|--|
| 企业名称  | 南通通润达投资有限公司                                    |
| 企业性质  | 有限责任公司（法人独资）                                   |
| 成立日期  | 2015 年 10 月 10 日                               |
| 注册地址  | 南通苏通科技产业园区江成路 1088 号内 3 号楼 2778 室              |
| 法定代表人 | 石磊   |
| 注册资本  | 3000 万元整                                       |
| 经营范围  | 股权投资、项目投资、项目及投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

#### （六）交易价款及调价机制

##### 1、交易价款及调价机制

根据《股权购买协议》，本次交易的调整前交割价格为  $43,600 \times 85\% = 37,060$  万美元，卖方须在交割日前至少 5 个工作日内，向买方提供按协议约定的方式计算的预计净债务、预计营运资金以及预计营运资金调整额，最终按照本次标的资产的股权比例，确定交割日的资产购买价格。

本次交易的交割日股权购买价格为：

调整前交割价格-预计净债务（Estimated Net Debt Amount） $\times 85\%$ +预计营运资金调整额（Estimated Working Capital Adjustment Amount） $\times 85\%$ 。

交割完成后 60 日内，买方需向卖方提供截至交割日的标的公司的资产负债

表，并计算实际净债务、实际营运资金以及实际营运资金调整额，交易双方据此调整交割日股权购买价格，并根据调整净额由买方或卖方进行差额支付。

对净债务调整方式为：

(1) 如果实际净债务 (Actual Net Debt Amount) 大于预计净债务，卖方需按照 85% 的比例向买方进行差额支付；

(2) 如果实际净债务小于预计净债务，买方需按照 85% 的比例向卖方进行差额支付；

对营运资金调整额的交易对价调整方式为：

(1) 如果实际营运资金调整额 (Actual Working Capital Adjustment Amount) 小于预计营运资金调整额，卖方需按照 85% 的比例向买方进行差额支付。

(2) 如果实际营运资金调整额大于预计营运资金调整额，买方需按照 85% 的比例向卖方进行差额支付。

净债务=交割时债务-交割时现金

交割时债务包括标的公司针对借款的所有债务，以及该等债务的应计未付利息；未支取信用证及针对未支取信用证的偿付义务；标的公司作为债务人、标的公司关联方作为债权人的任何公司间债务减去标的公司一家或多家关联方（包括卖方及其关联方）作为债务人、标的公司作为债权人的任何公司间债务的差额。

交割时现金包括现金及现金等价物，包括有价证券、任何现金抵押支持债券、许可或其他类似票据和任何存款。

营运资金指截至交割日标的公司的合并流动资产（不包括期末现金），减去标的公司的合并流动负债（不包括期末债务）的差额。

营运资金调整额=截至交割日的预计营运资金余额-目标营运资金余额

关于交易双方根据调整净额，进行差额支付的假设测算如下：

| 交割日股权购买价格 |              |    |
|-----------|--------------|----|
| 项目        | 数额<br>(百万美元) | 备注 |
|           |              |    |

|                                     |                      |  |
|-------------------------------------|----------------------|--|
| 调整前交割价格                             | 370.6                | 交易双方调整前交割价格初步确定为<br>43,600 万美元×85%                                   |
| 预计净债务                               | -10*                 | 假设：预计净负债-1000 万美元  |
| 预计营运资金调整额                           | -6*                  |  |
| 交割日股权购买价格                           | 374                  | =370.6- (-10) ×85%+ (-6) ×85%  |
| <b>交割完成后 60 日内，交易双方根据调整净额进行差额支付</b> |                      |  |
| <b>项目</b>                           | <b>数额<br/>(百万美元)</b> | <b>备注</b>  |
| 实际净债务                               | -6*                  | 假设：实际净负债-600 万美元   |
| 净债务调整额                              | -4                   |  |
| 实际营运资金调整额                           | -11*                 |  |
| 交割后调整总额                             | -7.65                | 正值表示由买方向卖方进行差额支付；<br>负值表示由卖方向买方进行差额支付；<br>=(-4)×85%+[-11- (-6) ]×85% |
| 实际股权购买价格                            | 366.35               | =374-7.65  |

注：上表中预计净债务-10 百万美元、实际净债务-6 百万美元、预计营运资金调整额 6 百万美元、实际营运资金调整额 11 百万美元为假设值，仅用于理解实际股权购买价格的测算过程。

## 2、交易价款调整的会计处理

股权交割当日，交易双方根据交割日股权购买价格，确认合并成本。交割日后 60 日内，交易双方根据净债务、营运资金、营运资金调整额实际值与预计值之间的差异，对交割日所确定的股权初始投资成本进行调整。根据《上市公司执行企业会计准则案例解析》（证监会会计部）、《企业会计准则讲解 2010》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》等相关规定，上市公司应做如下会计处理：

(1) 股权交割日，以交割日股权购买价格确认合并成本；

(2) 交割日完成后 60 日内，根据上市公司对净债务、营运资金、营运资金调整额实际值与预计值之间差异所支付或收到的调整价款，作为公司在购买日后 12 个月内根据出现对购买日已存在情况的新的或者进一步证据而需要调整或有对价的情形进行处理，应视同在购买日发生，对合并成本进行追溯调整，相应调整商誉金额；

(3) 上市公司在购买日后每一个资产负债表日，均需进行商誉减值测试，商誉一经减值，不得冲回。

### （七）本次交易不会导致上市公司实际控制人变更

本次交易前，上市公司的实际控制人为石明达，本次交易完成后，上市公司实际控制人仍为石明达，本次交易未导致上市公司控制权发生变化。

## 二、本次重组构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成借壳

### （一）本次交易构成重大资产重组

本次交易的标的公司的资产总额或交易金额、资产净额或交易金额、所产生的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告的期末资产总额、资产净额、营业收入的比例如下（由于标的公司资产总额、资产净额以及营业收入占比均达到重大资产重组标准，故不对交易金额指标另行测算）：

单位：万元

| 2014年12月31日/2014年度 | 标的公司合计     | 上市公司合计     | 占比      |
|--------------------|------------|------------|---------|
| 资产总额               | 218,555.31 | 395,505.30 | 55.26%  |
| 资产净额               | 170,280.06 | 236,448.95 | 72.02%  |
| 营业收入               | 253,453.05 | 209,068.58 | 121.23% |

注：标的公司资产总额、资产净额、营业收入合计以及交易金额兑换人民币的价格按照2014年12月31日马来西亚林吉特以及美元对人民币汇率中间价计算；资产总额占比为标的公司资产总额与上市公司资产总额之比；资产净额占比为标的公司资产净额与上市公司资产净额之比；营业收入占比为标的公司营业收入与上市公司营业收入之比。

参照《重组办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。

### （二）本次交易不构成关联交易

根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，交易对方与公司及其关联方之间不存在关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。

### （三）本次交易不构成借壳

自发行上市以来，本公司控制权未发生变更，本次交易前石明达先生持有华

达微 39.09%股权，华达微持有本公司 31.09%股权为公司第一大股东，石明达先生为本公司实际控制人。本次交易完成后，石明达先生所持华达微股权比例以及华达微所持本公司股权比例均不发生变化，不存在实际控制人变更的情况。本次交易标的公司 2014 年度末资产总计及本次交易金额，均未达到 2014 年末上市公司合并财务报表资产总额的 100%。因此，本次重组不属于《重组办法》第十三条规定的借壳上市的情形。

### 三、本次交易的预估作价情况

根据《股权购买协议》，本次交易的调整前交割价格为  $43,600 \times 85\% = 37,060$  万美元，卖方须在交割日前至少 5 个工作日内，向买方提供按协议约定的方式计算的预计净债务、预计营运资金以及预计营运资金调整额，最终按照本次标的资产的股权比例，确定交割日标的资产购买价格。

截至本预案签署日，标的公司的审计、估值工作尚未完成；AMD 苏州以及 AMD 槟城股东全部权益预估值为 57,629 万美元，账面净资产值（未经审计）为 28,008.09 万美元，预估增值率为 105.76%。

### 四、业绩目标与安排

经过初步协商，双方在股权转让协议的附件中，就标的公司的业绩目标和安排具体如下：

“AMD 承诺支持两家标的公司执行初始商业计划中有关 AMD 股东部分的业务，支持两家标的公司达成收入和利润目标（两家标的公司每个财政年度合计共 2,000 万美元利润，自本协议生效日起 36 个月内有效）。“利润”是指按美国通用会计准则计算、未扣息、税的与 AMD 有关的利润。如某一财政年度不是完整年度，则收入和利润目标应当按比例予以调整。收入和利润目标将合并考虑两家标的公司的财务业绩。如两家标的公司严重偏离事先同意的目标，双方应善意地尽最大努力共同协作，采取双方同意的措施来达到目标，包括增加 AMD 的采购量、调整公司的成本、调整 AMD 的采购价。在按照本协议约定尽最大努力的过程中，若双方任何一方采取或避免采取的任何措施将对其盈利能力或商业利益造成不利影响，则任何一方将无义务采取或避免采取该等措施。

在计算是否达到利润目标时，标的公司获得的政府补贴不计算在内，除非该等政府补贴与交割日前安装在标的公司的运营设施直接相关或者与 AMD 产品或技术实质上关联，那么该等政府补贴的 50%可被计入利润目标。在计算利润目标时，以下因素不予考虑：1、标的公司因重新对资产估值或改变折旧规定导致资产账面价值变化；2、标的公司向其他客户提供服务发生的费用；3、各方同意的标的公司的 AMD 业务商业计划未规定的费用；4、标的公司未能履行义务或向其他客户违约造成的责任、开支、费用或标的公司没有可用的产能、技术稳定性、质量或价格竞争力来提供服务。如标的公司实现利润超过预定目标的 10%，则超过 10%部分计入下一财政年度 AMD 的利润目标。AMD 有权聘请独立审计机构核实该条项下标的公司的财务指标。AMD 应提前 5 个工作日通知标的公司，且该类审计每六个月仅可进行一次。”

最终条款将在资产重组报告书中予以披露。

## 五、本次重组对上市公司的影响

本次收购完成后，有利于公司提升国际影响力，提升中国企业在海外市场的知名度；引进先进的生产设备、掌握先进的封装测试技术，开发高端产品，取得更高的利润率水平，在市场竞争中获得优势地位。

标的公司将成为上市公司的控股子公司，有利于公司统筹开展各项业务和公司发展战略的实施，上市公司将在巩固标的公司现有的销售区域、市场份额的基础上，进一步开拓高端客户在先进封装与测试领域的需求，在市场以及销售渠道的协同下，预计未来上市公司的盈利能力将进一步增强，符合全体股东的利益。本次交易完成后，将有利于上市公司提升盈利能力。

## 六、本次重组已履行的以及尚未履行的决策程序及报批程序

本次交易已经履行的决策和审批程序包括：

AMD 已召开董事会，批准了本次交易以及相关协议的签署。

2015 年 10 月 15 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于本次交易的相关议案。

2015年10月15日，交易双方签署了《股权购买协议》。

本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：

1、待公司相关的审计、估值等工作完成后再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案；

2、公司股东大会审议通过本次交易；

3、国家发改委或其地方分支机构备案；

4、江苏省商务厅的备案；

5、公司注册地银行：根据《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发[2015]13号），公司需到注册地银行进行关于本次交易涉及的境内机构境外直接投资外汇登记（如适用）；

6、AMD 交付有关通过本次交易的内部决议文件；

7、AMD 取得苏州工业园区商务部门的批复；

8、AMD 取得马来西亚国际贸易及工业部的批复；

## 七、本次重组相关方所作出的重组承诺

| 承诺方       | 承诺事项         | 承诺内容   |
|-----------|--------------|--|
| 上市公司及全体董事 | 提交信息真实、准确和完整 | 本公司及全体董事保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。<br>与本次重大资产重组相关的审计、估值工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。                        |
|           | 合法合规情况       | 本公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。   |
| AMD 苏州    | 提交信息真实、准确和完整 | 作为本次交易的目标公司，AMD 苏州承诺在合理要求的范围内，并受限于相关的保密承诺为重大资产重组提供在重大方面真实、准确和完整的以下信息的副本：<br>截至交割日向买方提供的 AMD 苏州公司的账簿和其他记录在各重要方面均为完整和准确的，反映实际正当交易，并在各重要方面根据良好商业惯例保存。 |

| 承诺方    | 承诺事项         | 承诺内容  |
|--------|--------------|---|
| AMD 槟城 | 提交信息真实、准确和完整 | 作为本次交易的目标公司，AMD 槟城承诺在合理要求的范围内，并受限于相关的保密承诺为重大资产重组提供在重大方面真实、准确和完整的以下信息的副本：<br>截至交割日向买方提供的 AMD 槟城公司的账簿和其他记录在各重要方面均为完整和准确的，反映实际正当交易，并在各重要方面根据良好商业惯例保存。  |
| 交易对方   | 提交信息真实、准确和完整 | 作为本次交易的对方，Advanced Micro Devices, Inc.（“卖方”）承诺在合理要求的范围内，并受限于相关的保密承诺为重大资产重组提供在重大方面真实、准确和完整的以下信息的副本：<br>截至交割日向买方提供的每一目标公司的账簿和其他记录在各重要方面均为完整和准确的，反映实际正当交易，并在各重要方面根据良好商业惯例保存。   |
|        | 目标资产所有权的承诺函  | 作为本次交易的对方，Advanced Micro Devices, Inc. 作出如下承诺：<br>每一目标公司的所有股权均经合法授权和有效发行、缴足股款、无追加出资义务、且其发行未违反任何优先购买权或类似权利。全部股权由相关卖方控股公司实际拥有并记录在案，且不存在任何留置权，除了(a)可能在目标公司的组织文件中列明、或(b)有关适用证券法律项下任何证券出售限制规定。任何目标公司均未授予可转换或交换或行使为股权或该等目标公司任何其他股权的任何未行使的期权、认股权、权利或其他证券、或做出有关规定发行额外股权或该等目标公司任何其他股权、或回购或赎回股权或该等目标公司任何其他股权的任何其他承诺或约定，且不存在任何类型的任何协议而可能使任何目标公司有义务发行、购买、赎回或以其他方式收购其任何股权或该等目标公司的任何其他股权。除本协议以外，不存在有关股权或目标公司任何其他股权的表决权、转让或其他处分的任何表决权信托、股东协议、委托书或其他约定或谅解。任何目标公司均不直接或间接地拥有或持有任何其他主体的任何股权。 |
|        | 规范关联交易的承诺函   | 承诺人与通富微电、AMD 苏州、AMD 槟城之间的关联交易，将在所有重大方面遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行所适用的合法程序。本承诺自承诺人持有 AMD 苏州、AMD 槟城股份期间不可撤销。   |
|        | 避免资金占用的承诺函   | 本次交易完成后，Advanced Micro Devices, Inc. 以及其所控制的其他企业将尽商业合理努力预防和杜绝 AMD 苏州以及 AMD 槟城的非经营性占用资金情况发生，不违规使用 AMD 苏州以及 AMD 槟城的资  |

| 承诺方 | 承诺事项 | 承诺内容   |
|-----|------|--|
|     |      | 金及其他资产、资源，不以直接或间接方式从事损害通富微电、AMD 苏州及 AMD 槟城及其股东利益的行为。 |

## 八、本次交易对方与上市公司及其实际控制人之间的一致行动关系

本次重大资产重组交易对方与上市公司及其实际控制人之间不存在一致行动关系。

## 重大风险提示

投资者在评价本公司此次重大资产重组时，还应审慎考虑下述各项风险因素。

### 一、本次交易有关的风险

#### （一）审批风险

本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：

1、待公司相关的审计、估值等工作完成后再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案；

2、公司股东大会审议通过本次交易；

3、国家发改委或其地方分支机构备案；

4、江苏省商务厅的备案；

5、公司注册地银行：根据《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发[2015]13号），公司需到注册地银行进行关于本次交易涉及的境内机构境外直接投资外汇登记（如适用）；

6、AMD 交付有关通过本次交易的内部决议文件；

7、AMD 取得苏州工业园区商务部门的批复；

8、AMD 取得马来西亚国际贸易及工业部的批复。

本次交易能否取得上述批准、通过审查或核准，及取得上述批准、核准、通过审查的时间存在不确定性。因此，重组方案的最终成功实施存在审批风险。

#### （二）国际化经营的风险

本次交易的标的公司之一的 AMD 槟城为一家境外公司，其主要资产在马来西亚，标的公司与本公司在法律法规、会计税收制度、商业管理、公司管理制度、企业文化等经营管理环境方面均存在差异。

本次交易完成后，公司在标的公司人力资源、管理、运营、生产等方面的整合到位尚需一定时间，公司在培养国际化经营管理人才方面尚需一定投入。本次交易后，公司和标的公司的经营管理能否达到预期存在一定的不确定性。

### **（三）商誉减值风险**

由于本次股权购买是非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。

本次股权购买完成后公司将会确认较大额度的商誉，若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的公司所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

### **（四）公司治理风险和整合风险**

本次交易前，上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和中国证监会及深交所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度。本次交易完成后，公司将新增两家子公司，管理、协调和信息披露工作量及工作难度有所增加。上市公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构，维护上市公司及中小股东的利益。若上市公司不能加强合规管理，则可能面临公司治理失效的风险。

本次交易完成后，为发挥协同效应，上市公司和标的公司需在客户资源管理、市场营销、技术研发、财务核算、人力资源管理等方面进行一定程度的优化整合。但是，整合能否顺利实施存在一定的不确定性，整合可能无法达到预期效果，甚至可能会对标的公司乃至上市公司原有业务的运营产生不利影响，提请投资者注意收购整合风险。

### **（五）法律、政策风险**

本次交易涉及中国、美国、马来西亚、香港等地的法律与政策，公司为中国注册成立的上市公司，而标的公司之一位于马来西亚，交易对方位于美国，存在政府和相关监管机构出台不利于本次交易的相关法律、政策或展开调查行动的风

险。

### **（六）战略投资者合作不确定的风险**

公司拟与包括产业基金在内的战略投资者共同出资对标的资产进行收购，目前，公司已就本次交易与产业基金初步达成共同投资意向，具体投资合作细节及相关商务条款还在具体协商中，不排除最终无法达成合作的风险。

如上市公司与包括产业基金在内的战略投资者未就本次交易达成合作，上市公司将自筹资金完成本次交易。

### **（七）业绩目标与安排尚未签署的风险**

公司与交易对方就标的公司的业绩目标与安排的相关条款尚未签署，存在不确定性的风险。

## **二、交易标的有关风险**

### **（一）客户集中度高的风险**

本次收购前，AMD 苏州及 AMD 槟城系 AMD 下属专门从事封装与测试业务的子公司，主要用于承接 AMD 内部的芯片封装与测试的业务，本次重组前，AMD 系 AMD 苏州及 AMD 槟城的唯一客户。虽然本次交易后上市公司将会积极开拓除 AMD 之外的其他客户资源，但在短时间内 AMD 苏州及 AMD 槟城的客户仍将以 AMD 为主。

若今后 AMD 经营状况出现较大变动，导致 AMD 自身对于封装及测试的需求量减少，则标的公司将由于客户集中度高而面临经营波动的风险。

### **（二）行业波动的风险**

上市公司及标的公司的业务情况和盈利能力受半导体行业的景气状况影响较大，而半导体行业具有周期性波动的特点。受全球金融危机的影响，2008 年第四季度和 2009 年，半导体行业景气度直线下降，跌至谷底；2010 年，开始强劲复苏，而我国集成电路市场增速领先于全球市场。2011 年受欧债危机影响，半导体行业全年景气度呈现前高后低的走势，2012 年延续 2011 年的低迷状态，

行业整体在低谷徘徊。2013年景气度有所回升，2014年继续保持复苏态势。半导体行业在发展过程中的波动会对本公司及标的公司的经营业绩产生一定影响。上市公司将会密切关注市场需求动向，加快技术创新步伐，及时进行产品结构与生产计划的调整，降低行业波动给标的公司带来的经营风险。

### **（三）标的资产的估值风险**

由于与本次交易相关的审计、估值等相关工作尚未完成，目前公司只能根据现有的财务和业务资料，在假设宏观环境和标的公司生产经营状况不发生重大变化的前提下，基于标的公司现有资产以及未来盈利状况所做出的初步价值判断。本预案所引用的标的公司预估值可能与最终估值结果存在差异。在此提请投资者关注相关风险。

## **三、其他风险**

### **（一）外汇风险**

由于标的公司的日常运营中涉及美元、马来西亚林吉特等货币，而公司的合并报表记账本位币为人民币。人民币与其他货币之间汇率的不断变动，将可能给本次交易及公司未来运营带来汇兑风险。

### **（二）股票投资风险**

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。公司本次交易的相关部门审批工作，尚需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的投资风险。

### **（三）其他风险**

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

## 目录

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 一、本次重组方案主要内容.....                   | 3         |
| 二、本次重组构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成借壳.....   | 7         |
| 三、本次交易的预估作价情况.....                  | 8         |
| 四、业绩目标与安排.....                      | 8         |
| 五、本次重组对上市公司的影响.....                 | 9         |
| 六、本次重组已履行的以及尚未履行的决策程序及报批程序.....     | 9         |
| 七、本次重组相关方所作出的重组承诺.....              | 10        |
| 八、本次交易对方与上市公司及其实际控制人之间的一致行动关系.....  | 12        |
| <b>重大风险提示.....</b>                  | <b>13</b> |
| 一、本次交易有关的风险.....                    | 13        |
| 二、交易标的有关风险.....                     | 15        |
| 三、其他风险.....                         | 16        |
| <b>释义.....</b>                      | <b>19</b> |
| <b>第一节 本次交易概况.....</b>              | <b>22</b> |
| 一、本次交易的背景及目的.....                   | 22        |
| 二、本次交易的具体方案.....                    | 25        |
| 三、本次交易符合《重组办法》第十一条对重大资产重组要求的情况..... | 30        |
| 四、本次交易构成重大资产重组.....                 | 32        |
| 五、本次交易不构成借壳上市.....                  | 33        |
| 六、本次交易不构成关联交易.....                  | 33        |
| 七、本次交易的决策过程.....                    | 33        |
| <b>第二节 上市公司基本情况.....</b>            | <b>35</b> |
| 一、上市公司基本信息.....                     | 35        |
| 二、公司设立及历史沿革.....                    | 35        |
| 三、最近三年的控制权变动情况.....                 | 38        |
| 四、最近三年的重大资产重组情况.....                | 38        |
| 五、上市公司主营业务情况.....                   | 38        |
| 六、主要财务指标.....                       | 39        |
| 七、公司控股股东及实际控制人情况.....               | 39        |
| 八、公司符合启动本次重组条件的其他情况.....            | 39        |
| 九、公司及其主要管理人员最近三年内受行政处罚的情况.....      | 40        |
| 十、公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年诚信情况.....     | 40        |
| <b>第三节 交易对方基本情况.....</b>            | <b>41</b> |
| 一、交易对方基本情况.....                     | 41        |
| 二、交易对方与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图..... | 41        |
| 三、交易对方主要业务发展情况.....                 | 42        |
| 四、交易对方最近两年主要财务指标.....               | 43        |
| 五、交易对方下属企业名目.....                   | 43        |
| 六、关于交易对方的其他说明.....                  | 44        |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第四节 交易标的基本情况</b> .....         | 45 |
| 一、AMD 苏州基本情况.....                 | 45 |
| 二、AMD 槟城基本情况.....                 | 63 |
| <b>第五节 交易标的估值</b> .....           | 79 |
| 一、交易标的预估值.....                    | 79 |
| 二、预估方法说明.....                     | 79 |
| 三、预估作价合理性分析.....                  | 80 |
| <b>第六节 本次交易对上市公司的影响</b> .....     | 82 |
| 一、本次交易对上市公司主营业务的影响.....           | 82 |
| 二、本次交易对上市公司盈利能力的影响.....           | 83 |
| 三、本次交易对上市公司股权结构的影响.....           | 84 |
| 四、本次交易对上市公司同业竞争和关联交易的影响.....      | 84 |
| 五、本次交易对公司治理的影响.....               | 85 |
| <b>第七节 风险因素</b> .....             | 86 |
| 一、本次交易有关的风险.....                  | 86 |
| 二、交易标的有关风险.....                   | 88 |
| 三、其他风险.....                       | 89 |
| <b>第八节 其他重大事项</b> .....           | 90 |
| 一、保护中小投资者的措施.....                 | 90 |
| 二、独立董事的意见.....                    | 92 |
| 三、公司股票连续停牌前股票价格无异常波动的说明.....      | 93 |
| 四、交易标的资金占用情况.....                 | 93 |
| 五、关联方担保情形.....                    | 93 |
| 六、最近十二个月重大资产交易情况.....             | 94 |
| 七、关于不得参与重大资产重组情形的说明.....          | 94 |
| 八、公司利润分配政策、相应的安排及董事会对前述情况的说明..... | 94 |
| <b>第九节 独立财务顾问的核查意见</b> .....      | 98 |
| <b>第十节 上市公司及全体董事声明</b> .....      | 99 |

## 释义

| 第一部分：常用词语            |   |   |
|----------------------|---|---|
| 通富微电、公司、本公司、上市公司、收购方 | 指 | 南通富士通微电子股份有限公司  |
| 华达微                  | 指 | 南通华达微电子集团有限公司   |
| AMD 苏州               | 指 | 超威半导体技术（中国）有限公司   |
| AMD 槟城               | 指 | Advanced Micro Devices Export SDN.BHD   |
| 标的公司、目标公司            | 指 | AMD 苏州、AMD 槟城   |
| 标的资产、拟购买资产           | 指 | AMD 苏州 85%股权、AMD 槟城 85%股权   |
| 本次交易、本次重组、本次重大资产重组   | 指 | 通富微电现金收购 AMD 苏州 85%股权、AMD 槟城 85%股权的行为   |
| 交易对方、AMD、卖方          | 指 | Advanced Micro Devices, Inc.  |
| 交易双方                 | 指 | 通富微电与 Advanced Micro Devices, Inc.  |
| AMD 中国               | 指 | 超威半导体（中国）有限公司   |
| AMD 马来西亚             | 指 | Advanced Micro Devices SDN.BERHAD   |
| 通润达                  | 指 | 南通通润达投资有限公司（通富微电为实施本次交易于中国境内设立的第一层收购平台）   |
| SPV (HK)             | 指 | 通润达于香港设立的全资子公司  |
| 产业基金                 | 指 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司  |
| 交易价格                 | 指 | 根据《股权购买协议》，本次对标的资产的调整前交割价格为 $43,600 \times 85\% = 37,060$ 万美元。截至本预案签署日，标的资产的估值工作尚未完成，标的公司股东全部权益预估值为 57,629 万美元。 |
| 预估值基准日               | 指 | 2015 年 6 月 30 日   |
| 本预案、重组预案             | 指 | 《南通富士通微电子股份有限公司重大资产购买预案》  |
| 重组报告书                | 指 | 《南通富士通微电子股份有限公司重大资产购买报告书》   |
| 《股权购买协议》             | 指 | 南通富士通微电子股份有限公司与 Advanced Micro  |

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
|                  |   | Devices, Inc.签署的《股权购买协议》  |
| 交割日              | 指 | 指上市公司与购买资产的交易对方就标的股权过户完成工商变更登记之日  |
| 中国证监会、证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 深交所              | 指 | 深圳证券交易所   |
| 国家发改委            | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会   |
| 商务部              | 指 | 中华人民共和国商务部  |
| 外汇管理局            | 指 | 国家外汇管理局   |
| 独立财务顾问、招商证券、估值机构 | 指 | 招商证券股份有限公司  |
| 财务顾问、广发证券        | 指 | 广发证券股份有限公司  |
| 法律顾问、金杜律所        | 指 | 北京市金杜律师事务所  |
| 致同会计师            | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 《重组办法》           | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》  |
| 元、万元、亿元          | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元  |
| <b>第二部分：专业词语</b> |   |   |
| 芯片               | 指 | 用半导体工艺在硅等材料上制造的集成电路   |
| 封装               | 指 | 将通过测试的晶圆加工得到独立芯片的过程，保护电路芯片免受周围环境的影响（包括物理、化学的影响），起着保护芯片、增强导热（散热）性能、实现电气和物理连接、功率分配、信号分配，以沟通芯片内部与外部电路的作用 |
| 晶圆               | 指 | 多指单晶硅圆片，由普通硅沙拉制提炼而成，是最常用的半导体材料，按其直径分为4英寸、5英寸、6英寸、8英寸等规格，近来发展出12英寸甚至更大规格，目前以8英寸为主流                     |
| APU              | 指 | 加速处理器，系一系列由AMD公司推出，将中央处理  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | 器和独显核心集成在一个晶片上的芯片产品                          |
| CPU  | 指 | 中央处理器  |
| PC   | 指 | 个人电脑   |
| SiP (SIP)  | 指 | System in a Package的缩写, 系统级封装                |
| SOP  | 指 | 小尺寸封装  |
| QFP  | 指 | 四侧引脚扁平封装                                     |
| TQFP   | 指 | 薄塑封四角扁平封装                                    |
| MCM  | 指 | 多芯片组件封装技术                                    |
| MEMS   | 指 | 微电子机械系统封装                                    |
| BGA  | 指 | 球栅阵列封装                                       |
| PGA  | 指 | 插针网格阵列封装                                     |
| LGA  | 指 | 栅格阵列封装                                       |
| IDM  | 指 | 从事集成电路设计、芯片制造、封装测试及产品销售的垂直整合型公司              |
| FC   | 指 | Flip-Chip, 倒焊芯片, 一种裸芯片封装技术                   |
| WLCSP  | 指 | Wafer level Chip size package 的缩写, 晶圆级芯片尺寸封装 |
| DIP  | 指 | Dual in-line Package的缩写, 双列直插式封装             |
| TO   | 指 | Transistor out-line 的缩写, 晶体管外壳封装             |
| TSV  | 指 | 晶圆级系统封装——硅通孔                                 |
| PLCC   | 指 | plastic leaded chip carrier的缩写, 一种表面贴装型封装技术  |
| QFN  | 指 | Quad Flat Non-leaded package的缩写, 四侧无引脚扁平封装   |
| QFP  | 指 | Quad Flat Package的缩写, 方型扁平式封装                |
| WLP  | 指 | Wafer Level Package的缩写, 晶圆级封装                |
| CSP  | 指 | Chip Scale Package的缩写, 芯片尺寸封装                |
| ** 本预案中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据预案中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。 |   |  |

## 第一节 本次交易概况

### 一、本次交易的背景及目的

#### (一) 本次交易的背景

##### 1、通过海外收购“走出去”，整合优质资产

2014年国务院《政府工作报告》中明确提出：“在走出去中提升竞争力。推进对外投资管理方式改革，实行以备案制为主，大幅下放审批权限。”随着中国综合国力的提升和中国企业的发展，新形势促使中国企业寻求更多的发展空间，中国企业“走出去”发展，可以帮助企业利用国内国外两个市场，在全球范围内整合优质资产，逐步推动产业升级。

近年来，越来越多的中国企业通过对外直接投资的方式，将产业链和市场延伸到海外。根据《2014年度中国对外直接投资统计公报》数据显示：2002-2014年的年均增长速度高达37.5%，连续12年实现增长；2014年，中国对外直接投资创下1,231.2亿美元的历史最高值，同比增长14.2%。2014年末，中国对外直接投资存量8,826.4亿美元，占全球外国直接投资流出存量份额3.4%，在全球分国家地区的对外直接投资存量排名中步入全球前10行列。

实施“走出去”的发展战略，已经成为中国企业参与国际合作和竞争的重要战略举措。本次收购响应了符合国务院“走出去”的发展战略，同时符合通富微电国际化的发展战略。

##### 2、中国半导体封装测试行业处于高速发展阶段

受全球经济不景气的影响，全球半导体行业经历了2008-2012年的增长乏力。进入2013年，半导体行业开始进入复苏，销售额首次突破3,000亿美元，达到3,056亿美元，增幅达4.8%；2014年，行业继续复苏，销售额同比增长9.4%，为自2010年以来的最高增长率。在垂直化专业分工模式发展等因素驱动下，全球主要的半导体芯片厂商均将其集成电路产业链中的封装测试环节转移至我国。2014年，中国大陆封装测试销售额达到1,255.9亿元。

从中长期角度来看，全球集成电路封装测试产业向中国转移的趋势仍将持

续。在以 3G/4G 为代表的网络通信市场和以多媒体化为代表的数字消费市场日益增长的需求驱动下，我国集成电路产业将继续保持较快的发展速度。作为半导体集成电路产业的重要组成部分，IC 封装测试业销售增速会随着集成电路产业同步发展。

### 3、国家产业政策大力扶持半导体产业

国际金融危机后，世界各国都在努力探寻经济转型之路，加快培育发展战略性新兴产业，力争在后危机时代的全球经济发展和竞争中赢得先机。集成电路技术和产业具有极强的创新力和融合力，已经渗透到工业生产、社会生活以及国防安全和信息安全的方方面面，其战略地位进一步凸显。拥有强大的集成电路技术和产业，是迈向创新型国家的重要标志。

大力发展集成电路产业是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础，是转变经济发展方式、调整产业结构、保障国家信息安全的重要支撑。集成电路封测产业是集成电路产业的重要组成部分，国内企业间竞争激烈且在与国际同行竞争的过程中处于相对劣势，亟需加快技术提升。

《集成电路产业“十二五”发展规划》指出：到“十二五”末，产业规模再翻一番以上，关键核心技术和产品取得突破性进展，结构调整取得明显成效，产业链进一步完善，形成一批具有国际竞争力的企业。

目前，在半导体封装测试行业，高端技术和高端产品的市场份额仍然由行业国际巨头占据。内地厂商则仍然以中低端为主，高端产品未形成规模效应，发达国家在技术水平上占有优势。跨境收购具有半导体封装测试领先的企业，可以使国内企业较快学习境外先进技术与管理方式，提升内地集成电路企业的实力，促进其技术升级，做强内地集成电路企业。

## （二）本次交易的目的

### 1、提高国际影响力及行业地位

AMD作为世界领先的半导体芯片提供商，在先进封装技术领域具有一定的技术优势，管理团队拥有丰富的业务和管理经验，在全球市场享有相当的声誉和地位。本次收购完成后，上市公司将调整生产布局，将标的公司先进技术、品牌与国内以及槟城的成本优势整合，发挥协同优势，提升公司的国际影响力，以及

在海外市场的认知度。

本次交易完成后，标的公司的主要产品与技术将与上市公司业务形成有效互补，有助于上市公司提升技术和服务水平，实现品牌优势。

## 2、掌握先进的封装测试技术

基于上游半导体集成电路产品设计与制造的推动，以及下游领域的终端电子产品的多元化、智能化、轻薄化、便携性等需要，封装技术快速进行更新换代，水平不断突破。国内具有一定实力的半导体封装厂商通过加大技术投入，通过引进先进的生产设备，不断提高产品的技术水平，开发新型产品，取得更高的利润率水平，获得优势地位。

标的公司掌握并应用 PGA 封装技术、BGA-stiffener 封装技术、BGA-coreless 封装技术以及 LGA-coreless 封装技术等世界主流先进封装技术，并具有国际先进的经营管理经验。目前国内企业中，掌握上述主流关键技术并实施批量化生产的企业仅有长电科技、晶方科技、华天科技以及本公司等少数几家上市公司。本次交易完成后，上市公司将进一步巩固自身在国内行业技术的领先地位。

## 3、进一步提升上市公司的盈利能力

截至 2015 年 6 月末，AMD 苏州实现营业收入 30,381.02 万元，净利润 2,866.74 万元。按照 2015 年 6 月 30 日马来西亚林吉特对人民币汇率中间价计算，截至 2015 年 6 月末，AMD 槟城实现营业收入 59,568.28 万元，净利润 5,369.93 万元，AMD 苏州与 AMD 槟城营业收入合计 89,949.30 万元、净利润 8,236.67 万元（以上数据均未经审计）。截至 2015 年 6 月末，上市公司实现营业收入 111,015.51 万元、净利润 8,412.52 万元。本次交易完成后，将有利于上市公司提高盈利能力。

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司，有利于公司统筹开展各项业务及有效实施公司国际化发展战略，上市公司将在巩固标的公司现有的销售区域、市场份额的基础上，进一步开拓高端客户在先进封装与测试领域的需求，在市场以及销售渠道的协同下，预计未来上市公司的盈利能力将进一步增强，符合全体股东的利益。

## 二、本次交易的具体方案

### （一）本次交易方案概要

根据上市公司与 AMD 签订的《股权购买协议》，本次交易的标的为 AMD 位于中国的全资子公司 AMD 中国所持有的 AMD 苏州 85%股权，以及 AMD 位于马来西亚的全资子公司 AMD 马来西亚所持有的 AMD 槟城 85%股权。

通富微电已就本次交易设立第一层收购平台通润达，产业基金等战略投资者拟以股权投资和或债权投资等方式作为共同投资人对通润达进行增资，通润达将以现金购买 AMD 苏州 85%股权。同时，通润达将在香港设立全资子公司 SPV (HK)，SPV (HK)将以现金购买 AMD 槟城 85%股权。

### （二）交易对方

本次交易对方为 Advanced Micro Devices, Inc.。其与上市公司不存在关联关系。交易对方具体情况请详见本预案“第三节 交易对方基本情况”。

### （三）战略投资者

本次交易的战略投资者拟包括国家集成电路产业投资基金股份有限公司，其基本情况如下：

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 企业名称  | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司                   |
| 企业性质  | 股份有限公司（非上市）                          |
| 成立日期  | 2014 年 9 月 26 日                      |
| 注册地址  | 北京市市辖区经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 718 室 |
| 法定代表人 | 王占甫                                  |
| 经营范围  | 股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询           |

产业基金与通富微电无任何关联关系。

### （四）交易标的

本次交易标的为 AMD 苏州以及 AMD 槟城各 85%股权，AMD 苏州及 AMD 槟城具体情况请详见本预案“第四节 交易标的基本情况”

## （五）实施主体

本次交易中用于收购 AMD 苏州 85%股权的实施主体为通润达，用于收购 AMD 槟城 85%股权的实施主体为通润达的全资子公司 SPV (HK)。通润达的基本信息如下：

|       |  |
|-------|--|
| 企业名称  | 南通通润达投资有限公司                                    |
| 企业性质  | 有限责任公司（法人独资）                                   |
| 成立日期  | 2015 年 10 月 10 日                               |
| 注册地址  | 南通苏通科技产业园区江成路 1088 号内 3 号楼 2778 室              |
| 法定代表人 | 石磊   |
| 注册资本  | 3000 万元整                                       |
| 经营范围  | 股权投资、项目投资、项目及投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

## （六）交易价款及调价机制

### 1、交易价款及调价机制

根据《股权购买协议》，本次交易的调整前交割价格为  $43,600 \times 85\% = 37,060$  万美元，卖方须在交割日前至少 5 个工作日内，向买方提供按协议约定的方式计算的预计净债务、预计营运资金以及预计营运资金调整额，最终按照本次标的资产的股权比例，确定交割日标的资产购买价格。

本次交易的交割日股权购买价格为：

调整前交割价格-预计净债务（Estimated Net Debt Amount） $\times 85\%$ +预计营运资金调整额（Estimated Working Capital Adjustment Amount） $\times 85\%$ 。

交割完成后 60 日内，买方需向卖方提供截至交割日的标的公司的资产负债表，并计算实际净债务、实际营运资金以及实际营运资金调整额，交易双方据此调整交割日股权购买价格，并根据调整净额由买方或卖方进行差额支付。

对净债务调整方式为：

（1）如果实际净债务（Actual Net Debt Amount）大于预计净债务，卖方需按照 85%的比例向买方进行差额支付；

（2）如果实际净债务小于预计净债务，买方需按照 85%的比例向卖方进行

差额支付；

对营运资金调整额的交易对价调整方式为：

(1) 如果实际营运资金调整额(Actual Working Capital Adjustment Amount)小于预计营运资金调整额，卖方需按照 85%的比例向买方进行差额支付。

(2) 如果实际营运资金调整额大于预计营运资金调整额，买方需按照 85%的比例向卖方进行差额支付。

净债务=交割时债务-交割时现金

交割时债务包括标的公司针对借款的所有债务，以及该等债务的应计未付利息；未支取信用证及针对未支取信用证的偿付义务；标的公司作为债务人、标的公司关联方作为债权人的任何公司间债务减去标的公司一家或多家关联方(包括卖方及其关联方)作为债务人、标的公司作为债权人的任何公司间债务的差额。

交割时现金包括现金及现金等价物，包括有价证券、任何现金抵押支持债券、许可或其他类似票据和任何存款。

营运资金指截至交割日标的公司的合并流动资产(不包括期末现金)，减去标的公司的合并流动负债(不包括期末债务)的差额。

营运资金调整额=截至交割日的预计营运资金余额-目标营运资金余额

关于交易双方根据调整净额，进行差额支付的假设测算如下：

| 交割日股权购买价格                    |                  |                                 |
|------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 项目                           | 数额<br>(百万美元)     | 备注                              |
| 调整前交割价格                      | 370.6            | 交易双方调整前交割价格初步确定为 43,600 万美元×85% |
| 预计净债务                        | -10 <sup>*</sup> | 假设：预计净负债-1000 万美元               |
| 预计营运资金调整额                    | -6 <sup>*</sup>  |                                 |
| 交割日股权购买价格                    | 374              | =370.6-(-10)×85%+(-6)×85%       |
| 交割完成后 60 日内，交易双方根据调整净额进行差额支付 |                  |                                 |
| 项目                           | 数额<br>(百万美元)     | 备注                              |
| 实际净债务                        | -6 <sup>*</sup>  | 假设：实际净负债-600 万美元                |
| 净债务调整额                       | -4               |                                 |

|           |        |   |
|-----------|--------|---|
| 实际营运资金调整额 | -11*   |   |
| 交割后调整总额   | -7.65  | 正值表示由买方向卖方进行差额支付；<br>负值表示由卖方向买方进行差额支付；<br>= $(-4) \times 85\% + [-11 - (-6)] \times 85\%$ |
| 实际股权购买价格  | 366.35 | = $374 - 7.65$  |

注：上表中预计净债务-10 百万美元、实际净债务-6 百万美元、预计营运资金调整额 6 百万美元、实际营运资金调整额 11 百万美元为假设值，仅用于理解实际股权购买价格的测算过程。

## 2、交易价款调整的会计处理

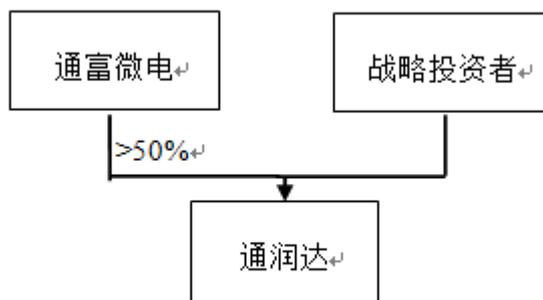
股权交割当日，交易双方根据交割日股权购买价格，确认合并成本。交割日后 60 日内，交易双方根据净债务、营运资金、营运资金调整额实际值与预计值之间的差异，对交割日所确定的股权初始投资成本进行调整。根据《上市公司执行企业会计准则案例解析》（证监会会计部）、《企业会计准则讲解 2010》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》等相关规定，上市公司应做如下会计处理：

- （1）股权交割日，以交割日股权购买价格确认合并成本；
- （2）交割日完成后 60 日内，根据上市公司对净债务、营运资金、营运资金调整额实际值与预计值之间差异所支付或收到的调整价款，作为公司在购买日后 12 个月内根据出现对购买日已存在情况的新的或者进一步证据而需要调整或有对价的情形进行处理，应视同在购买日发生，对合并成本进行追溯调整，相应调整商誉金额；
- （3）上市公司在购买日后每一个资产负债表日，均需进行商誉减值测试，商誉一经减值，不得冲回。

### （七）本次交易的主要步骤

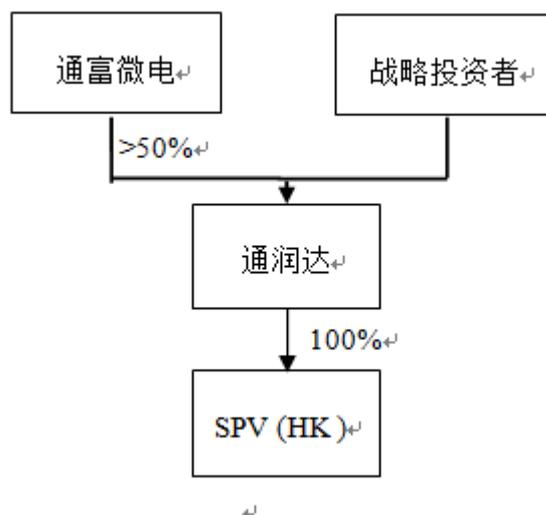
#### 1、搭建第一层收购平台

通富微电已就本次交易设立第一层收购平台通润达，本次交易的战略投资者（拟包括但不限于产业基金），将与上市公司共同对通润达增资和（或）以债务形式为通润达提供资金支持，用于收购 AMD 苏州 85% 股权，增资完成后通润达的股权架构如下：



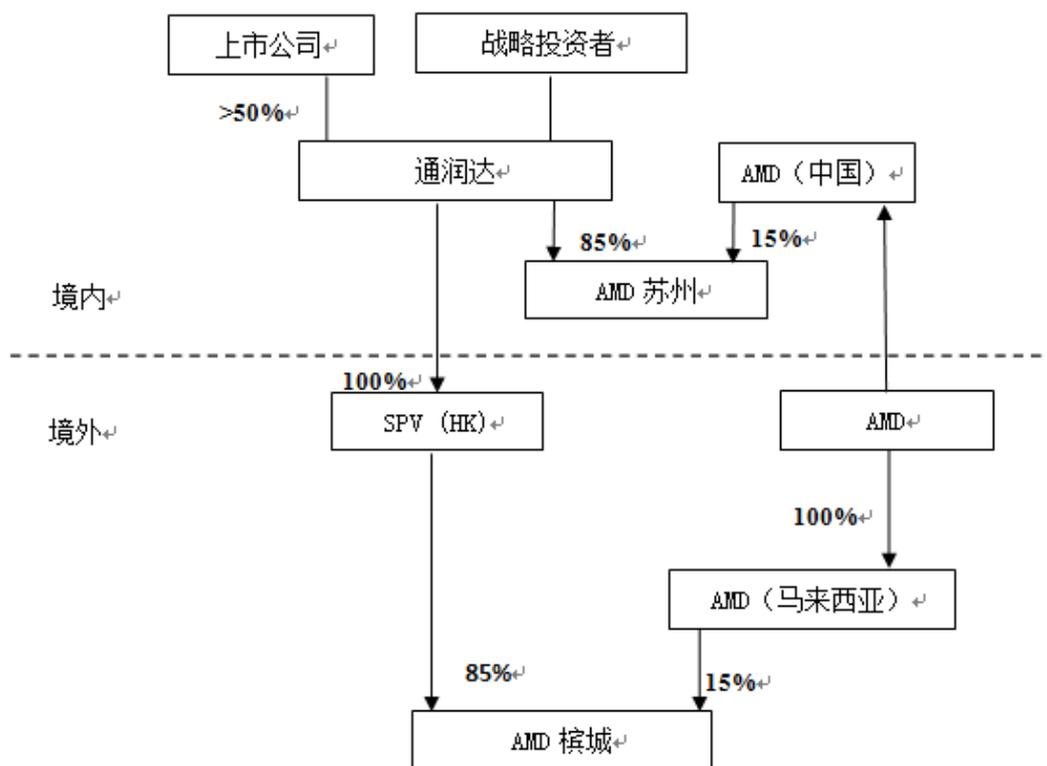
## 2、第一层收购平台设立位于香港的境外收购主体 SPV (HK)

通润达设立位于香港的 SPV (HK)，用于收购 AMD 槟城 85%股权：



## 3、对标的资产进行收购

境内收购主体通润达收购 AMD 苏州 85%股权，境外收购主体 SPV (HK)收购 AMD 槟城 85%股权，收购完成后的股权架构如下：



### 三、本次交易符合《重组办法》第十一条对重大资产重组要求的情况

#### (一) 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

本次重组符合国家相关产业政策，工业和信息化部发布的《集成电路行业“十二五”发展规划》中提出调整优化行业结构，着力发展芯片设计业，壮大芯片制造业，提升封装测试层次，增强关键设备、仪器、材料的自主开发和供给能力。按照“扶优、扶强、扶大”的原则，优化企业组织结构，推进企业兼并、重组、联合。本次重组的交易标的为 AMD 苏州以及 AMD 槟城各 85% 股权，AMD 苏州与 AMD 槟城拥有较强的封装与测试运营管理能力，收购后能与公司形成技术、产品、客户上的互补与协同，有利于公司的长远发展。同时，标的公司的生产经营符合本国及其所在国有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定。

本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。

## **（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件**

本次重组拟采用现金购买 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85% 股权，本次重组完成后，上市公司社会公众股股份数量占本次重组后总股本的比例不低于 10%，满足相关法律法规规定的股票上市条件，本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。

## **（三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形**

本次交易中，标的资产的调整前交割价格以招商证券在预估值基准日（2015 年 6 月 30 日）的预估值结论为参考，由交易双方协商确定。

本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。本次交易按照相关法律法规的规定依法进行，由上市公司董事会提出方案，并聘请具有证券从业资格的中介机构依据有关规定出具审计、估值、法律等相关报告。截至本预案签署日，标的公司的审计和估值工作正在进行中。

## **（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法**

本次交易的标的公司为依照我国法律以及马来西亚法律依法设立和存续的有限责任公司的股权，不存在出资不实或影响其合法存续的情形。交易对方承诺，交易对方所拥有的标的公司权属清晰、完整，不存在质押、权利担保或其它受限制的情形，能够按照交易合同约定进行过户，不存在重大法律障碍。

## **（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形**

本次交易前，上市公司的主营业务是为境内外半导体企业提供 IC 的封装测试服务，主要封装产品包括 SOP/SOT/TSSOP、QFP/LQFP、MCM（MCP）、QFN/PDFN、BGA、SiP、BUMP、WLCSP、Cu pillar、FC（Flip Chip）等系列产品，并提供微处理器、数字电路、模拟电路、数模混合电路、射频电路的 FT 测试及 PT 圆片测试服务；标的公司主要从事集成电路封装测试业务，可以满足从处理器半成品切割、组装、测试、打标、封装的五大 CPU 后期制造流程，

使其同时具备对中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）以及加速处理器（APU）进行封装和测试的能力。

本次交易完成后，上市公司主营业务没有发生变化，但提供产品的品种及市场得以深化拓展，上市公司持续经营能力增强，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

#### **（六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定**

本次交易前，上市公司在资产、人员、财务、机构和业务方面保持独立。本次交易后，标的公司将继续按照有关法律法规的规定保持规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，保持上市公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性。

#### **（七）本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构**

本次交易前，上市公司已建立了健全有效的法人治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。本次交易完成后，上市公司将根据法律、法规和规范性文件的要求进一步完善上市公司及其子公司的治理结构和管理制度，继续保持健全有效的法人治理结构。

综上，本次交易符合《重组办法》第十一条的要求。

### **四、本次交易构成重大资产重组**

本次交易的标的公司的资产总额或交易金额、资产净额或交易金额、所产生的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告的期末资产总额、资产净额、营业收入的比例如下（由于标的公司资产总额、资产净额以及营业收入占比均达到重大资产重组标准，故不对交易金额指标另行测算）：

单位：万元

| 2014年12月31日 | 标的公司合计 | 上市公司合计 | 占比 |
|-------------|--------|--------|----|
|-------------|--------|--------|----|

| <b>/2014 年度</b> |            |            |         |
|-----------------|------------|------------|---------|
| 资产总额            | 218,555.31 | 395,505.30 | 55.26%  |
| 资产净额            | 170,280.06 | 236,448.95 | 72.02%  |
| 营业收入            | 253,453.05 | 209,068.58 | 121.23% |

注：标的公司资产总额、资产净额、营业收入合计以及交易金额兑换人民币的价格按照 2014 年 12 月 31 日马来西亚林吉特以及美元对人民币汇率中间价计算；资产总额占比为标的公司资产总额与上市公司资产总额之比；资产净额占比为标的公司资产净额与上市公司资产净额之比；营业收入占比为标的公司营业收入与上市公司营业收入之比。

参照《重组办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。

## 五、本次交易不构成借壳上市

自发行上市以来，本公司控制权未发生变更，本次交易前石明达先生持有华达微 39.09%股权，华达微持有本公司 31.09%股权为公司第一大股东，石明达先生为本公司实际控制人。本次交易完成后，石明达先生所持华达微股权比例，以及华达微所持本公司股权比例均不发生变化，不存在实际控制人变更的情况。本次交易标的公司 2014 年度末资产总计及本次交易金额，均未达到 2014 年末上市公司合并财务报表资产总额的 100%。因此，本次重组不属于《重组办法》第十三条规定的借壳上市的情形。

## 六、本次交易不构成关联交易

根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，交易对方与公司及其关联方之间不存在关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。

## 七、本次交易的决策过程

### （一）本次交易已经取得的批准

本次交易已经履行的决策和审批程序包括：

AMD 已召开董事会，批准了本次交易以及相关协议的签署。

2015 年 10 月 15 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于本次交

易的相关议案。

2015年10月15日，交易双方签署了《股权购买协议》。

## **（二）本次交易尚须履行的批准**

1、本次交易相关审计、估值报告出具后，公司须再次召开董事会审议本次交易相关事项；

2、本次交易方案尚须取得公司股东大会的批准；

3、交易对方股东大会审议通过本次交易方案；

4、国家发改委或其地方分支机构备案；

5、江苏省商务厅备案；

6、公司注册地银行：根据《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发[2015]13号），公司需到注册地银行进行关于本次交易涉及的境内机构境外直接投资外汇登记（如适用）；

6、AMD 交付有关通过本次交易的内部决议文件；

7、AMD 取得苏州工业园区商务部门的批复；

8、AMD 取得马来西亚国际贸易及工业部的批复；

## 第二节 上市公司基本情况

### 一、上市公司基本信息

公司名称：南通富士通微电子股份有限公司  
英文名称：NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO.,LTD  
法定代表人：石明达  
股票上市地：深圳证券交易所  
股票简称：通富微电  
股票代码：002156  
首发时间：2007年8月16日  
注册资本：748,177,011元  
营业执照注册号：320000400001029  
经营范围：研究开发、生产集成电路等半导体产品，提供相关的技术服务。  
注册地址：江苏省南通市崇川开发区崇川路288号  
办公地址：江苏省南通市崇川路288号  
邮政编码：226006  
电话号码：0513-85058919  
传真号码：0513-85058929  
电子信箱：nfme\_stock@fujitsu-nt.com

### 二、公司设立及历史沿革

#### （一）通富微电设立、首次发行时的股本情况

1、通富微电系由原南通富士通微电子有限公司整体变更而来。2002年12月，经原中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资二函【2002】1375号文批准并经国家工商行政管理总局核准，南通富士通微电子有限公司以截至2002年6月30日经审计的净资产14,585万元按1:1的比例整体变更为股份公司，整体变更后通富微电股本总数为14,585万股，注册资本为14,585万元。江苏天衡会计师事务所有限公司2002年12月17日对通富微电的整体变更出具了天

衡验字（2002）75号《验资报告》。通富微电整体变更后的股权结构为：

| 股东名称            | 持股数（股）      | 股权比例    |
|-----------------|-------------|---------|
| 南通华达微电子有限公司     | 84,140,865  | 57.69%  |
| 富士通（中国）有限公司     | 56,093,910  | 38.46%  |
| 南通万捷计算机系统有限责任公司 | 3,748,345   | 2.57%   |
| 江苏东洋之花化妆品有限责任公司 | 933,440     | 0.64%   |
| 江苏恒诚科技有限公司      | 933,440     | 0.64%   |
| 合计              | 145,850,000 | 100.00% |

2、2006年10月12日，根据2006年第二次临时股东大会决议，通富微电向现有股东派送股票股利5,415万元；2006年12月29日，国家商务部以商资批【2006】2514号文批准公司未分配利润转增方案，通富微电的注册资本增至20,000万元，股本总数增加至20,000万股；北京京都会计师事务所有限责任公司对此次增资出具北京京都验字（2006）第069号验资报告。通富微电增资后的股权结构如下：

| 股东名称            | 持股数（股）      | 股权比例   |
|-----------------|-------------|--------|
| 南通华达微电子集团有限公司   | 115,380,000 | 57.69% |
| 富士通（中国）有限公司     | 76,920,000  | 38.46% |
| 南通万捷计算机系统有限责任公司 | 5,140,000   | 2.57%  |
| 江苏东洋之花化妆品有限责任公司 | 1,280,000   | 0.64%  |
| 江苏恒诚科技有限公司      | 1,280,000   | 0.64%  |
| 合计              | 200,000,000 | 100%   |

注：①2006年12月18日，南通华达微电子有限公司更名为南通华达微电子集团有限公司；②江苏东洋之花化妆品有限责任公司2014年已更名为“江苏东洋之花生物科技股份有限公司”。

3、2007年7月23日，经中国证监会以证监发行字【2007】192号文《关于核准南通富士通微电子股份有限公司申请公开发行股票的通知》批准，核准发行人向社会公众发行人民币普通股6,700万股，发行价格8.82元/股，股票发行成功后，通富微电股本增至26,700万股，注册资本增加至26,700万元。上述注册资本变更已经商务部以商资批【2007】2005号文作出批准。

2007年8月14日，经深圳证券交易所以深证上【2007】130号文批准，通富微电社会公众股部分在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称为“通富微电”，股票代码为“002156”。

## （二）首次公开发行后股本变动情况

公司首次公开发行后股本变动情况如下：

### 1、2009年5月，资本公积转增股本

经公司股东大会决定，2009年5月22日通富微电以总股本26,700万股为基础，按照每10股转增3股的比例，将通富微电资本公积中的8,010万元转增为公司注册资本，通富微电注册资本增加至34,710万元，总股本增加至34,710万股。上述注册资本变更已经江苏省对外贸易经济合作厅以苏外经贸资【2009】690号文作出批准。

### 2、2010年11月，公开增发A股

2010年11月9日，中国证监会证监许可【2010】1590号文件《关于核准南通富士通微电子股份有限公司增发股票的批复》核准通富微电向社会公众发行人民币普通股不超过10,000万股。公司于2010年11月16日以16.93元/股的发行价公开增发59,066,700股人民币普通股，并于2010年12月1日在深交所上市。上述公开增发的股份每股面值为人民币1元。股票发行成功后，通富微电股本增至40,616.67万股，注册资本增加至40,616.67万元。上述注册资本变更已经江苏省商务厅以苏商资【2011】191号文作出批准。

### 3、2011年4月，资本公积转增股本

经公司2010年度股东大会决定，2011年4月29日通富微电以总股本40,616.67万股为基础，按照每10股转增6股的比例，将通富微电资本公积中的24,370.002万元转增为公司注册资本，通富微电注册资本增加至64,986.672万元，总股本增加至64,986.672万股。上述注册资本变更已经江苏省商务厅以苏商资【2011】625号文作出批准。

### 4、2015年4月，非公开发行A股

经中国证监会《关于核准南通富士通微电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】370号）核准，通富微电向财通基金管理有限公司等7名特定投资者非公开发行A股股票98,310,291股，发行价格13.02元/股，并于2015年4月30日在深圳证券交易所上市。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【致同验字（2015）第110ZA0161号】《验资报告》，截至2015年4月17日止，公司已收到股东认缴股款人民币1,252,839,989.07元（已扣除发行费用人民币27,159,999.75元），其中：股本98,310,291元，股东全部以货

币出资。本次非公开发行后，公司总股本增加至 748,177,011 股。

#### 本次发行对象及限售期

| 序号 | 发行对象名称       | 获配数量（股）           | 限售期   |
|----|--------------|-------------------|-------|
| 1  | 财通基金管理有限公司   | 23,041,474        | 12 个月 |
| 2  | 山西证券股份有限公司   | 9,892,473         | 12 个月 |
| 3  | 中国华电集团财务有限公司 | 9,831,029         | 12 个月 |
| 4  | 华宝信托有限责任公司   | 16,359,447        | 12 个月 |
| 5  | 国联安基金管理有限公司  | 16,897,081        | 12 个月 |
| 6  | 华安基金管理有限公司   | 14,592,933        | 12 个月 |
| 7  | 泰达宏利基金管理有限公司 | 7,695,854         | 12 个月 |
| 合计 |              | <b>98,310,291</b> |       |

### 三、最近三年的控制权变动情况

上市公司最近三年控制权未变动，第一大股东为南通华达微电子集团有限公司，实际控制人为石明达先生。

### 四、最近三年的重大资产重组情况

上市公司最近三年不存在重大资产重组情形。

### 五、上市公司主营业务情况

公司是由南通华达微电子有限公司和富士通(中国)有限公司共同投资、由中方控股的中外合资股份制企业。公司专业从事集成电路的封装和测试，是中国国内目前规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一。公司主要封装产品包括 SOP/SOT/TSSOP、QFP/LQFP、MCM（MCP）、QFN/PDFN、BGA、SiP、BUMP、WLCSP、Cu pillar、FC（Flip Chip）等系列产品，并提供微处理器、数字电路、模拟电路、数模混合电路、射频电路的 FT 测试及 PT 圆片测试服务。公司主要客户为世界半导体知名企业，世界排名前二十位的半导体企业有一半以上是公司客户。公司是中国电子信息百强企业，中国十大集成电路封装测试企业，中国进出口额最大企业 500 强，被日本富士通誉为“中日合作的典范”。

最近三年公司主营业务收入构成如下：

单位：万元

| 项目           | 2015年1-6月         |                | 2014年             |                | 2013年             |                |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|              | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             |
| 集成电路<br>封装测试 | 110,384.86        | 99.43%         | 208,052.21        | 99.51%         | 175,857.66        | 99.51%         |
| 其他           | 630.65            | 0.57%          | 1,016.37          | 0.49%          | 874.57            | 0.49%          |
| 合计           | <b>111,015.51</b> | <b>100.00%</b> | <b>209,068.58</b> | <b>100.00%</b> | <b>176,732.23</b> | <b>100.00%</b> |

## 六、主要财务指标

单位：万元

| 项目           | 2015年1-6月  | 2014年      | 2013年      |
|--------------|------------|------------|------------|
| 总资产          | 551,668.05 | 395,505.30 | 368,618.81 |
| 净资产          | 369,920.44 | 236,448.95 | 225,612.28 |
| 营业收入         | 111,015.51 | 209,068.58 | 176,732.23 |
| 利润总额         | 9,333.64   | 13,421.76  | 7,061.48   |
| 净利润          | 8,412.52   | 12,082.44  | 6,066.03   |
| 扣除非经常性损益后的归属 | 3,649.05   | 4,729.01   | 2,654.35   |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,725.61   | 41,507.43  | 30,942.95  |
| 资产负债率(%)     | 32.95      | 40.22      | 38.80      |
| 毛利率(%)       | 22.58      | 19.08      | 16.58      |
| 每股收益(元/股)    | 0.12       | 0.19       | 0.09       |

## 七、公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为南通华达微电子集团有限公司，持有公司 31.09%的股份，系公司第一大股东；石明达先生为南通华达微电子集团有限公司的控股股东，是本公司的实际控制人。

石明达先生，男，中国国籍，1945 年出生，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。1997 年 10 月起至今就职于本公司，历任总经理，副董事长，董事长，现任公司董事长。石明达先生在半导体研究，生产及管理方面具有多年工作经验，现为中国半导体行业协会副理事长，封装分会副理事长。

## 八、公司符合启动本次重组条件的其他情况

截至本预案签署日，公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

## **九、公司及其主要管理人员最近三年内受行政处罚的情况**

公司及其董事、高级管理人员最近三年内不存在受行政处罚、刑事处罚的情况。

## **十、公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年诚信情况**

公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年不存在受交易所公开谴责的情况。

### 第三节 交易对方基本情况

#### 一、交易对方基本情况

上市公司本次重大资产重组的交易对方为超威半导体，其基本情况如下：

公司名称：ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

公司类型：股份有限公司

成立日期：1969年5月1日

办公地址：One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, California 94088-3453

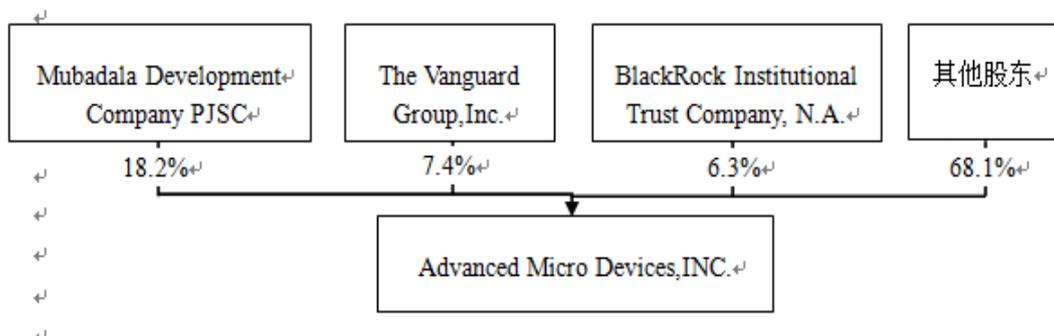
超威半导体是专门为计算机、通信和消费电子行业设计和制造各种创新的微处理器（CPU、GPU、APU、主板芯片组、电视卡芯片等）、闪存和低功率处理器解决方案的计算机领域的公司，是一家可以提供高性能 CPU、高性能独立显卡 GPU 芯片、主板芯片组三大组件的半导体公司。超威半导体在世界各主要城市设有销售办事处，是一家真正意义上的跨国公司。

超威半导体于 1972 年 9 月 1 日在纽约证券交易所（NYSE）上市，交易代码为 AMD，从 2015 年 1 月 2 日起，超威半导体股票从纽约证券交易所转至纳斯达克（NASDAQ），交易代码不变。

#### 二、交易对方与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构

图

截至 2015 年 6 月 30 日，超威半导体的股权结构图如下：



超威半导体主要股东为 Mubadala Development Company PJSC、The Vanguard Group 和 BlackRock Institutional Trust Company, N.A.，其他股东均为持股比例小于 5%的社会公众投资者。Mubadala Development Company PJSC (Mubadala) 建立于 2002 年 10 月，是由阿布扎比酋长国全资所有的投资和开发公司，注册形式为公开合股公司。超威半导体无控股股东和实际控制人，前述主要股东及其实际控制人与本公司、本公司控股股东均不存在关联关系。

截至 2015 年 6 月 30 日，超威半导体前十大股东情况如下：

| 排名 | 股东名称  | 持股数量        | 占比 (%) |
|----|---|-------------|--------|
| 1  | Mubadala Development Company PJSC           | 141,906,166 | 18.2   |
| 2  | The Vanguard Group, Inc.                    | 57,898,747  | 7.4    |
| 3  | BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 48,771,619  | 6.3    |
| 4  | OppenheimerFunds, Inc.                      | 32,000,000  | 4.1    |
| 5  | AllianceBernstein L.P.                      | 23,281,736  | 3      |
| 6  | State Street Global Advisors (US)           | 22,442,157  | 2.9    |
| 7  | Fidelity Management & Research Company      | 13,576,958  | 1.7    |
| 8  | Shanda Payment Holdings Ltd.                | 6,140,457   | 0.8    |
| 9  | Norges Bank Investment Management (NBIM)    | 6,053,273   | 0.8    |
| 10 | Chicago Equity Partners, LLC                | 5,386,160   | 0.7    |

### 三、交易对方主要业务发展情况

在全球半导体行业，超威半导体主要提供如下产品和服务：基于 X86 架构的 PC 和服务芯片，如加速处理器（APU）、芯片组以及独立图形处理器；游戏主机的核心芯片，如服务器和嵌入式处理器、半定制系统芯片（SoC）产品等。

2014 年度，超威半导体营业收入约为 55 亿美元，同比增长 4%，主要源于其半定制系统芯片（SoC）的销售收入增长，使得企业、嵌入式和半定制业务板块增长 51%；同时，由于桌面处理器和芯片组销售收入的下降，使得其计算和图形业务板块业务收入同比下降 16%。

作为 2014 年度的战略部署，超威半导体不断研发制造多样化的产品，满足高增速市场，全年约有 40%的销售收入来源于中国大陆。同年，超威半导体宣布将于 2016 年推出高品质的 ARM 和 X86 处理器内核，并展示了基于 28 纳米技术和 64 位 ARM 服务器处理器的 AMD Opteron™ A1100 系列产品。

#### 四、交易对方最近两年主要财务指标

单位：百万美元

| 项目                  | 2014-12-27      | 2013-12-28      |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 流动资产合计              | 2,736.00        | 2,884.00        |
| <b>资产总计</b>         | <b>3,767.00</b> | <b>4,337.00</b> |
| 流动负债合计              | 1,440.00        | 1,618.00        |
| <b>负债总计</b>         | <b>3,580.00</b> | <b>3,793.00</b> |
| <b>所有者权益合计</b>      | <b>187.00</b>   | <b>544.00</b>   |
|                     | <b>2014 年度</b>  | <b>2013 年度</b>  |
| 主营业务收入              | 5,506.00        | 5,299.00        |
| <b>净利润</b>          | <b>-403.00</b>  | <b>-83.00</b>   |
| 经营活动产生的现金流量净额       | -98.00          | -148.00         |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -12.00          | 455.00          |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 46.00           | 13.00           |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b> | <b>-64.00</b>   | <b>320.00</b>   |

超威半导体 2013 年和 2014 年会计年度分别为：2012 年 12 月 30 日至 2013 年 12 月 28 日、2013 年 12 月 29 日至 2014 年 12 月 27 日。

#### 五、交易对方下属企业名录

截至 2014 年 12 月 27 日，超威半导体主要的下属企业如下：

|  |         |
|--|---------|
| 美国境内下属公司                                       | 所在国家或地区 |
| Advanced Micro Ltd.                            | 美国加州    |
| AMD Corporation                                | 美国加州    |
| AMD Advanced Research LLC                      | 美国特拉华州  |
| AMD (EMEA) LTD.                                | 美国特拉华州  |
| AMD Far East Ltd.                              | 美国特拉华州  |
| AMD International Sales & Service, Ltd.        | 美国特拉华州  |
| AMD Latin America Ltd.                         | 美国特拉华州  |
| SeaMicro, Inc.                                 | 美国特拉华州  |
| 美国境外下属公司                                       | 所在国家或地区 |
| ATI International SRL                          | 巴巴多斯    |
| ATI Technologies (Bermuda) Limited             | 百慕大群岛   |
| Advanced Micro Devices Belgium N.V.            | 比利时     |
| AMD South America LTDA                         | 巴西      |
| 1252986 Alberta ULC                            | 加拿大     |
| ATI Technologies ULC                           | 加拿大     |
| Advanced Micro Devices (China) Co. Ltd.        | 中国      |
| AMD Technologies (China) Co. Ltd.              | 中国      |
| Advanced Micro Devices (Shanghai) Co. Ltd.     | 中国      |
| AMD Products (China) Co., Ltd                  | 中国      |
| AMD Technology Development (Beijing) Co., Ltd. | 中国      |

|   |      |
|---|------|
| ATI Visual Technologies (Shanghai) Co. Ltd.             | 中国   |
| DDEEG Microconsulting Oy                                | 芬兰   |
| Advanced Micro Devices S.A.S.                           | 法国   |
| Advanced Micro Devices GmbH                             | 德国   |
| AMD India Private Limited                               | 印度   |
| AMD Research & Development Center India Private Limited | 印度   |
| AMD Advanced Micro Devices Israel Ltd.                  | 以色列  |
| Advanced Micro Devices S.p.A.                           | 意大利  |
| AMD Japan Ltd.  | 日本   |
| Advanced Micro Devices Sdn. Bhd.                        | 马来西亚 |
| Advanced Micro Devices Export Sdn. Bhd.                 | 马来西亚 |
| Advanced Micro Devices Global Services (M) Sdn. Bhd.    | 马来西亚 |
| ATI Technologies (L) Inc.                               | 马来西亚 |
| Advanced Micro Devices Malaysia Ltd.                    | 马来西亚 |
| Advanced Micro Devices (Singapore) Pte. Ltd.            | 新加坡  |
| Advanced Micro Devices, AB                              | 瑞典   |
| Advanced Micro Devices (U.K.) Limited                   | 英国   |

## 六、关于交易对方的其他说明

截至本预案出具日，超威半导体与上市公司及其控股股东、持股比例超过5%的股东之间不存在关联关系，也不存在向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况。

## 第四节 交易标的基本情况

### 一、AMD 苏州基本情况

#### (一) 基本信息

|        |  |
|--------|--|
| 名称     | 超威半导体技术（中国）有限公司  |
| 企业性质   | 有限责任公司(外国法人独资)   |
| 注册地址   | 苏州工业园区苏桐路 88 号   |
| 法定代表人  | DEVINDER KUMAR   |
| 注册资本   | 13,338 万美元   |
| 成立日期   | 2004 年 3 月 26 日  |
| 注册号    | 320594400008574  |
| 组织机构代码 | 75966188-3   |
| 税务登记证  | 321700759661883  |
| 经营范围   | <p>特许经营项目：无</p> <p>一般经营项目：生产集成电路和电子元件，销售本公司所生产的产品并提供有关的售后服务及相关服务，提供维修业务以及为相关产品提供技术服务；自有多余厂房出租。</p> |

#### (二) 历史沿革

##### 1、AMD 苏州设立

2004 年 3 月 23 日，苏州工业园区管理委员会签发《关于设立外商独资企业“超威半导体技术（中国）有限公司”的批复》（苏园管复字[2004]52 号），2004 年 3 月 24 日，江苏省人民政府向 AMD 苏州核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资苏府资字[2004]49789 号）。

2004 年 3 月 26 日，江苏省工商行政管理局向 AMD 苏州核发《企业法人营业执照》（注册号：企独苏总字第 021473 号）。根据该《企业法人营业执照》，AMD 苏州于 2004 年 3 月 26 日设立，注册资本为 3,338 万美元。

2004 年 4 月 27 日，江苏华星会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华星会验字（2004）0234 号），验证截至 2004 年 4 月 12 日，AMD 苏州已收到出资方缴纳的货币资金合计 50 万美元，占注册资本总额的 1.5%；2004 年 7 月 14 日，江苏华星会计师事务所有限公司出具验资报告（华星会验字[2004]0368 号），验证截至 2004 年 6 月 17 日，AMD 苏州已累计收到出资方缴纳的货币资金合计

500 万美元，占注册资本的 15%；2005 年 9 月 23 日，江苏华星会计师事务所有限公司出具验资报告（华星会验字[2005]0382 号），验证截至 2005 年 8 月 26 日，AMD 苏州已累计收到出资方缴纳的货币资金合计 1,820 万美元，占注册资本的 54.5%；2005 年 11 月 29 日，江苏华星会计师事务所有限公司出具验资报告（华星会验字[2005]0478 号），验证截至 2005 年 10 月 14 日，AMD 苏州已累计收到出资方缴纳的货币资金合计 2,040 万美元，占注册资本的 61.11%；2006 年 2 月 24 日，江苏华星会计师事务所有限公司出具验资报告（华星会验字[2006]0065 号），验证截至 2005 年 12 月 19 日，AMD 苏州已累计收到出资方缴纳的货币资金合计 2,215 万美元，占注册资本的 66.36%；2006 年 9 月 14 日，江苏华星会计师事务所有限公司出具验资报告（华星会验字[2006]0302 号），验证截至 2006 年 9 月 7 日，AMD 苏州已累计收到出资方缴纳的货币资金合计 3,338 万美元，占注册资本的 100%。

2006 年 9 月 22 日，AMD 苏州取得江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：企独苏总字第 021473 号）。根据该证记载，AMD 苏州的实收资本变更为 3,338 万美元。

AMD 苏州设立时，工商局注册登记的股东、出资方式、出资额及出资比例如下所示：

| 序号 | 股东名称          | 出资金额（万美元） | 出资方式 | 出资比例 |
|----|---------------|-----------|------|------|
| 1  | 超威半导体（中国）有限公司 | 3,338     | 货币   | 100% |

## 2、AMD 苏州 2010 年增资

2010 年 6 月 29 日，AMD 苏州股东会决议，AMD 苏州新增注册资本 1 亿美元，其中 2,000 万美元将在 AMD 苏州获得新变更的营业执照前缴付。

2010 年 6 月 30 日，江苏省人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资苏府资字[2010]49789 号）。2010 年 7 月 26 日，苏州工业园区管理委员会签发《关于超威半导体技术（中国）有限公司增资的批复》（苏园管复字[2010]101 号），同意 AMD 苏州新增注册资本 10,000 万美元。

2010 年 10 月 25 日，江苏华星会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华

星会验字（2010）0260号），验证截至2010年10月19日，AMD苏州已收到出资方缴纳的货币资金合计5,338万美元，占注册总资本的40.02%；2010年12月30日，AMD苏州取得江苏省苏州工业园区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：320594400008574），根据该证记载，AMD苏州的注册资本为13,338万美元，实收资本为5,338万美元。

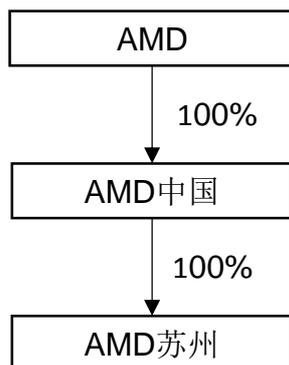
2014年2月28日，江苏华星会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华星会验字（2014）0018号），验证截至2014年2月27日，AMD苏州已收到出资方缴纳的注册资本合计7,738万美元，占注册总资本的58.01%；2014年3月31日，江苏华星会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华星会验字（2014）0031号），验证截至2014年3月28日，AMD苏州已收到出资方缴纳的注册资本合计9,338万美元，占注册总资本的70.01%，其中1,600万美元由AMD苏州的累计未分配利润转增实收资本；2014年6月19日，江苏华星会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华星会验字（2014）0052号），验证截至2014年6月18日，AMD苏州已收到出资方缴纳的注册资本合计13,338万美元，占注册总资本的100%。13,338万美元注册资本中共有2,750万美元由AMD苏州的累计未分配利润转增实收资本。

截至本预案出具日，AMD苏州的股东、出资方式、出资额及出资比例如下所示：

| 序号 | 股东名称          | 出资金额（万美元） |         | 出资比例 |
|----|---------------|-----------|---------|------|
|    |               | 货币资金      | 未分配利润转增 |      |
| 1  | 超威半导体（中国）有限公司 | 10,588    | 2,750   | 100% |

### （三）产权控制结构

截至本预案出具之日，标的公司的产权控制结构如下：



#### （四）主营业务情况

##### 1、主营业务所处行业及概况

AMD 苏州主要从事集成电路封装测试业务，可以满足从处理器半成品切割、组装、测试、打标、封装的五大 CPU 后期制造流程，使其同时具备对中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）以及加速处理器（APU）进行封装和测试的能力。AMD 苏州是 AMD 公司在中国最主要的封装测试厂家。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），AMD 苏州的主营业务属于计算机、通信和其他电子设备制造业。而 AMD 苏州从事的集成电路封装测试业务属于半导体集成电路制造业的一个细分产业。

半导体主要包括半导体集成电路（IC）、半导体分立器件两大分支，各分支包含的种类繁多且应用广泛，在消费类电子、通讯、精密电子、汽车电子、工业自动化等电子产品中有大量的应用。集成电路产业链是半导体产业的典型代表，因为其技术的复杂性，产业结构向高度专业化转化，分化为芯片设计业、芯片制造业及芯片封装测试业三个子产业群。

##### （1）行业管理体制

###### 1) 行业主管部门

国内集成电路制造业的产业行政主管部门是国家工业和信息化部，并由国家工业和信息化部下属的电子信息司具体负责。国家工业和信息化部电子信息司主要负责承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。

中国半导体行业协会是中国集成电路制造业的行业自律管理机构，主要职能是贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；做好信息咨询工作；调查、研究、预测本行业产业与市场，根据授权开展行业统计，及时向会员单位和政府主管部门提供行业情况调查、市场趋势、经济运行预测等信息，做好政策导向、信息导向、市场导向工作；广泛开展经济技术交流和学术交流活动；受政府委托承办或根据市场和行业发展需要，组织举办本行业国内外新产品、新技术研讨会和展览会，为企业开拓国内外两个市场服务；开展国际交流与合作。发展与国外团体的联系，促进产业发展，推动产业国际化等。

行业主管部门国家工业和信息化部 and 行业自律管理机构中国半导体行业协会构成了集成电路制造业的行业管理体系，各集成电路制造企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

## 2) 行业主要政策

集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，国家相继出台了若干支持、鼓励集成电路产业发展的政策。与集成电路产业相关的政策如下：

| 发布单位 | 发布时间     | 文件名称                               | 文件要点  |
|------|----------|------------------------------------|---|
| 国务院  | 2009年4月  | 《电子信息产业调整和振兴规划》                    | 今后三年，电子信息产业围绕九个重点领域，完成如下三个任务：第一，确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长；第二，突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术；第三，通过新应用带动新增长。同时继续完善集成电路产业体系，支持骨干制造企业整合优质资源，加大创新投入，推进工艺升级，支持集成电路重大项目建设与科技重大专项攻关相结合。 |
| 国务院  | 2010年10月 | 《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号） | 文件要求将新一代信息技术等七大战略性新兴产业加快培育成为先导产业和支柱产业，着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。  |
| 国务院  | 2011年1月  | 《进一步鼓励软件产业和                        | 为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环  |

|         |         |                                  |  |
|---------|---------|----------------------------------|--|
|         |         | 集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）       | 境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业，在财税、投融资、研究开发、进出口等各方面制定了许多优惠政策。在投融资方面，积极支持符合条件的软件企业和集成电路企业采取发行股票、债券等多种方式筹集资金，拓宽直接融资渠道。   |
| 财政部、国务院 | 2012年4月 | 《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》 | 再次强调了对软件产业和集成电路产业发展的企业财税支持，并清晰定义了集成电路生产企业、集成电路设计企业、符合条件的软件企业。  |
| 国务院     | 2014年3月 | 《2014政府工作报告》                     | 明确指出“在新一代移动通信、集成电路、大数据、先进制造、新能源、新材料等方面赶超先进，引领未来产业发展”。这是政府工作报告中首次提到集成电路产业。  |
| 国务院     | 2014年6月 | 《国家集成电路产业发展推进纲要》                 | 《纲要》提出“到2015年，全行业销售收入超过3500亿元。到2020年，与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%。到2030年，产业链主要环节达到国际先进水平，实现跨越发展。“在封装测试业方面，提升先进封装测试业发展水平。推动国内封装测试企业兼并重组，提高产业集中度。”《纲要》同时提出了八项保障措施以推进集成电路产业发展。 |

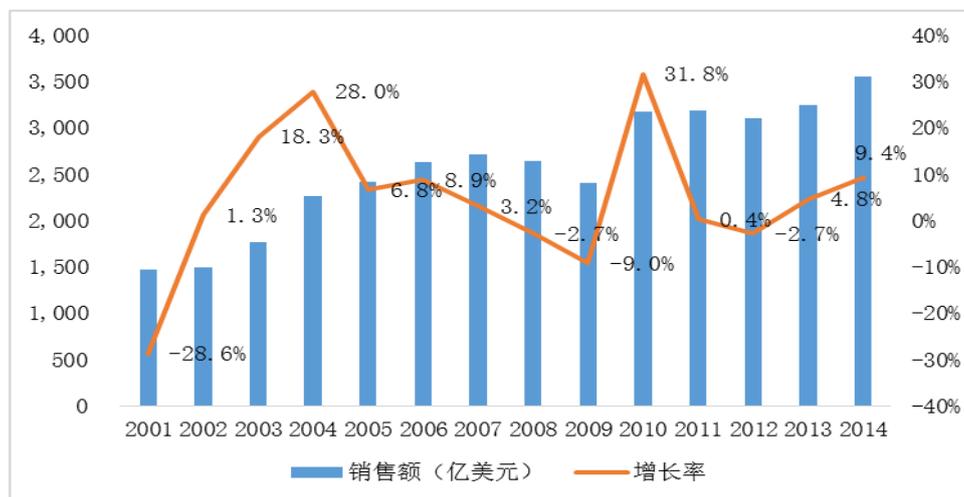
## (2) 行业市场情况

### 1) 集成电路行业发展状况及未来趋势

进入21世纪以后，随着全球化的深入，以及全球网络泡沫破灭后IT产品价格敏感性的提高，IT全球产业转移路径发生变化，典型的梯次转移转向由发达国家和地区向新兴发展中国家的直接转移。而我国大陆以劳动力成本优势、巨大的市场潜力和不断完善的投资环境，加上2001年加入WTO后带来的开放度日益提高，日益成为全球IT跨国公司产能转移的主要目标国，这直接推动了我国电子信息产业和半导体产业进入了超高速增长阶段，且我国集成电路和半导体产业的销售额占全球的比重整体呈不断增长趋势。在此背景下，从2000年到2007年间，我国集成电路产量和销售收入年均增长速度超过30%。受全球经济不景气的影响，中国集成电路产业在2008年和2009年出现了下滑，但随着国家拉动内需政策的迅速制定与深入实施，以及国际市场环境的逐步回暖，国内外集成电路行业在2009年第二季度起开始回暖，而由于欧债危机持续、世界经济增长

乏力等因素影响着半导体产业的发展，2011年起全球半导体产业销售收入增长率有所放缓，2011年、2012年和2013年全球半导体产业销售额分别同比增长0.4%、-2.7%和4.8%，2014年半导体行业出现复苏，销售额同比增长9.4%，为自2010年以来最高增长率。

2001-2014年全球半导体产业销售额及增长情况



资料来源：中国半导体行业协会

由于受到国内宏观经济持续稳定增长、集成电路行业产能向我国转移以及进口替代等因素的影响，国内集成电路产业经过多年持续快速发展，在全球集成电路行业地位日趋重要。我国集成电路产业2012年、2013年和2014年销售额较上年同比分别增长11.6%、16.2%和20.2%，近三年国内集成电路产业增长率高于全球水平。

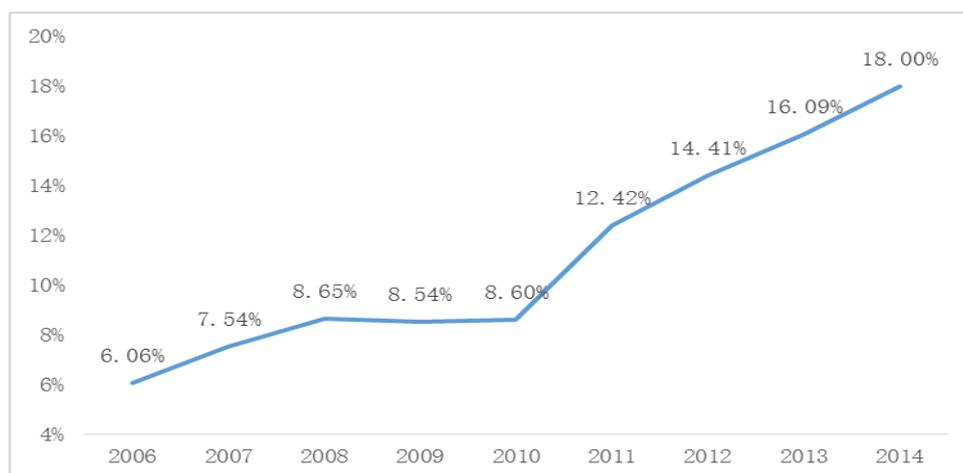
2001-2014年中国集成电路产业销售额及增长情况



资料来源：中国半导体行业协会

展望未来，随着发达国家走出低谷，发展中国家经济增长提速，全球经济回暖，消费市场重展活力，将为全球和我国集成电路产业带来新的增长。同时，伴随整体销售额在全球的份额不断提升，中国集成电路产业将在全球市场中获得更有影响力的地位。

2005-2014 年中国集成电路产业销售额占全球市场的份额



资料来源：《江苏省集成电路产业发展研究报告（2014 年度）》

## 2) 集成电路产业链结构及变化趋势

从国外 IC 产业发展经验看，IC 设计、IC 制造、IC 封装测试三个子行业的投资比例一般为 1：100：10，封装测试行业相对来说，投入资金适中，建设快，较利于再发展，许多发展中国家和地区都是先发展封装测试业，积累资金、市场和技术后再逐步发展 IC 设计业和 IC 制造业。我国在集成电路领域首先发展的即是封装测试业，由于具备成本和地缘优势，我国内陆已经成为全球第二大的封装测试基地（第一为中国台湾地区），IC 封装测试业在我国集成电路产业结构中一直占有较高的比例。虽然近几年因 IC 设计业的迅速发展，IC 封装测试业在国内集成电路产业中所占的比例不断下降，但作为集成电路产业的重要组成部分，IC 封装测试业销售增速会随着集成电路产业同步发展。目前，我国已经成为全球主要封装基地之一，封装测试业已成为中国半导体产业的主体，在技术上也开始向国际先进水平靠拢。2014 年度，我国集成电路封装测试业销售收入规模为 1,255.9 亿元，占集成电路产业销售收入的 41.7%。

2006 年-2014 年，我国大陆集成电路设计业、制造业、封装测试业销售额情况如下表所示：

单位：亿元

| 年度   | 2006年          | 2007年          | 2008年          | 2009年          | 2010年          | 2011年          | 2012年          | 2013年          | 2014年           |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 设计   | 186.2          | 225.7          | 235.2          | 269.9          | 363.9          | 526.4          | 621.7          | 808.8          | 1,047.4         |
| 芯片制造 | 308.5          | 397.9          | 392.7          | 341.1          | 447.1          | 431.6          | 501.1          | 600.9          | 708.45          |
| 封装测试 | 511.6          | 627.7          | 618.9          | 498.2          | 629.2          | 975.7          | 1,035.7        | 1,098.9        | 1,255.9         |
| 合计   | <b>1,006.3</b> | <b>1,251.3</b> | <b>1,246.8</b> | <b>1,109.1</b> | <b>1,440.2</b> | <b>1,933.7</b> | <b>2,158.5</b> | <b>2,508.6</b> | <b>3,011.75</b> |

### 3) 封装测试行业主要企业和市场份额

在劳动力、成本、税收优惠等因素促进下，国际上较大的集成电路制造商如英特尔（Intel）、超微（AMD）、三星电子及摩托罗拉等，以及封装测试代工类厂商如日月光等纷纷将其封装测试业务转移至我国大陆，形成了国内封装测试企业以外资为主的局面。外资封装测试企业在市场销售、生产规模、技术水平上都有明显的竞争优势，国内本土封装测试企业与外资企业存在一定的差距，但近年来本土大型封装测试企业如通富微电、长电科技、华天科技等已获得较快发展，其产品档次逐步由低端向中高端发展，在 BGA、CSP、MCM、MEMS、FC 和 SiP 等先进封装形式的开发和应用方面取得了显著成果。不少国际先进封装形式和先进封装技术已被国内封装测试企业突破，并迅速转向规模化生产。

#### 全球前十大封装测试企业 2013 年和 2014 年市场排名情况

单位：百万美元

| 公司        | 地区   | 2013 年度 |               | 2014 年度 |               |              |                |
|-----------|------|---------|---------------|---------|---------------|--------------|----------------|
|           |      | 排名      | 营业收入          | 排名      | 营业收入          | 同比增长率        | 市场份额           |
| 日月光       | 台湾   | 1       | 4,740         | 1       | 5,154         | 8.73%        | 9.56%          |
| Amkor     | 美国   | 2       | 2,956         | 2       | 3,129         | 5.85%        | 5.81%          |
| 矽品精密      | 台湾   | 3       | 2,335         | 3       | 2,742         | 17.43%       | 5.09%          |
| 星科金朋      | 新加坡  | 4       | 1,599         | 4       | 1,586         | -0.81%       | 2.94%          |
| Powertech | 台湾   | 5       | 1,276         | 5       | 1,241         | -2.74%       | 2.30%          |
| 长电科技      | 中国大陆 | 6       | 850           | 6       | 1,134         | 33.41%       | 2.10%          |
| UTAC      | 新加坡  | 7       | 748           | 7       | 734           | -1.87%       | 1.36%          |
| 南茂科技      | 台湾   | 8       | 649           | 8       | 696           | 7.24%        | 1.29%          |
| 欣邦科技      | 台湾   | 9       | 530           | 9       | 589           | 11.13%       | 1.09%          |
| 天水华天      | 中国大陆 | 10      | 398           | 10      | 523           | 31.41%       | 0.97%          |
| 前十名合计     |      |         | <b>16,081</b> |         | <b>17,528</b> | <b>9.00%</b> | <b>32.52%</b>  |
| 其他公司      |      |         | <b>34,719</b> |         | <b>36,372</b> | <b>4.76%</b> | <b>67.48%</b>  |
| 总计        |      |         | <b>50,800</b> |         | <b>53,900</b> | <b>6.10%</b> | <b>100.00%</b> |

数据来源：TechSearch、Gartner

我国台湾地区在集成电路封装测试领域具有很强的竞争优势，2014 年全球十大封装公司中台湾占到五席。目前，台湾当局已经逐步放开封装测试业技术向大陆的投资，从而进一步加剧国内封装测试业的竞争程度。

国内集成电路封装测试厂商主要分布于长三角、环渤海及珠三角等地区，其中长三角最为集中。按照规模和实力划分，现阶段国内具有规模的封装测试厂家可以分为三大类：第一类是国际大型整合组件制造商（IDM）独资或合资的封装测试厂；第二类是台资封装测试厂；第三类是内地本土封装测试厂。各类型的封装测试厂家在技术水平、生产规模、市场开发等方面都存在竞争差异。

#### 4) 封装测试行业技术状况

按照著名的摩尔定律：“芯片上的晶体管密度，每十八个月到二十四个月，在价格不变情况下，会增加一倍”。集成电路制造业的科技进步速度非常快，封装测试作为产业链中的一环，同样具有技术进步快、产品更新率高的特点。

从封装技术的发展历程看，半导体封装技术发展包括5个发展阶段，沿3个趋势发展：尺寸缩小、功能转换与性能提高、技术融合。最早出现的封装形态 DIP正在快速萎缩，目前，全球半导体封装的主流技术正处在第三阶段的成熟期，以CSP和BGA等主要封装形式进行大规模生产，同时也在向第四、第五阶段发展。

世界半导体封装技术经历的五个发展阶段

| 项目   | 时间            | 封装形式        | 具体典型的封装形式  |
|------|---------------|-------------|--|
| 第一阶段 | 20 世纪 70 年代以前 | 通孔插装型封装     | 晶体管封装（TO）、陶瓷双列直插封装（CDIP）、塑料双列直插封装（PDIP）、SIP（单列直插式封装）   |
| 第二阶段 | 20 世纪 80 年代以后 | 表面贴装型封装     | 塑料有引线片式载体封装（PLCC）、塑料四边引线扁平封装（PQFP）、小外形表面封装（SOP）、无引线四边扁平封装（PQFN）、小外形晶体管封装（SOT）、DFN（双边扁平无引脚封装） |
| 第三阶段 | 20 世纪 90 年代以后 | 球栅阵列封装（BGA） | 塑料焊球阵列封装（PBGA）、陶瓷焊球阵列封装（CBGA）、带散热器焊球阵列封装（EBGA）、倒装芯片焊球阵列封装（FC-BGA）                            |
|      |               | 晶圆级封装（WLP）  |  |
|      |               | 芯片级封装（CSP）  | 引线框架型 CSP 封装、柔性插入板 CSP 封装、刚性插入板 CSP 封装、圆片级 CSP 封装  |

|      |               |                   |   |
|------|---------------|-------------------|---|
| 第四阶段 | 20 世纪末开始      | 多芯片组装 (MCM)       | 多层陶瓷基板 (MCM-C)、多层薄膜基板 (MCM-D)、多层印制板 (MCM-L) |
|      |               | 系统级封装 (SiP)       |   |
|      |               | 三维立体封装 (3D)       |   |
| 第五阶段 | 21 世纪前 10 年开始 | 系统级单芯片封装 (SoC)    |   |
|      |               | 微电子机械系统封装 (MEMS)  |   |
|      |               | 晶圆级系统封装—硅通孔 (TSV) |   |
|      |               | 倒装焊封装 (Bumping)   |   |
|      |               | 表面活化室温连接 (SAB)    |   |

资料来源：《中国半导体封装业的发展》，毕克允

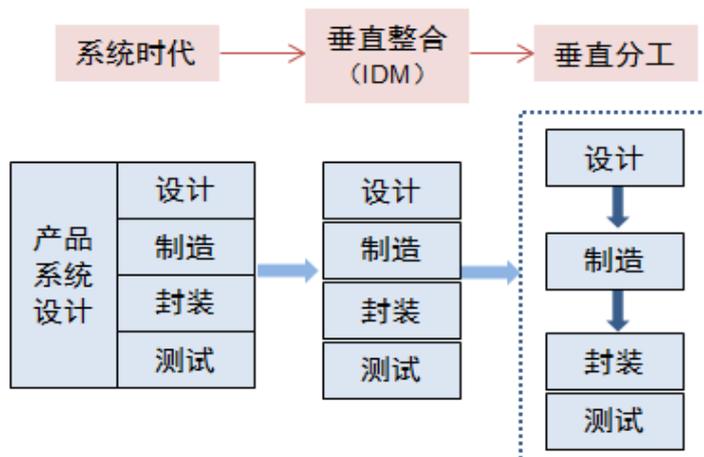
我国大陆半导体封装测试业整体水平和全球主流技术还存在较大的差距。随着我国集成电路封测产业技术创新步伐加快，附加值较高的第三代、第四代高端封装产品，如高速宽带网络芯片、多种数模混合芯片、专用电路芯片、信息安全芯片等一批系统级芯片产品实现批量化生产，BGA、WLP、SiP、TSV、3D等先进集成电路封装测试应运而生并实现了批量化生产，但是生产规模很小，尚不能满足国内高端市场日益增长的需求。而外资封装测试厂已经实现在全球生产资源配置，多采用主流BGA、CSP、MCM、MEMS等封装形式，技术水平高于本土企业。

集成电路封装技术的演进主要是为了符合终端系统产品的需求，由于系统产品具有多任务、小体积的趋势，集成电路封装技术也向高密度、高脚位、薄型化、小型化方向发展，由单芯片转为多芯片封装，由有引脚向无引脚封装发展。

### 5) 封装测试行业市场份额加大的归因

在20世纪70年代以前，集成电路产业尚未完全独立，基本是附属于大型系统厂商的一个业务部门，大型系统厂商从事所有的设计制造业务和产品系统的开发制造。随着大型系统厂商规模的增长导致机构臃肿，难以适应半导体产业技术变化快、创新活跃的特点，独立的半导体IDM企业开始壮大发展起来，产业进入了垂直整合时代。随着IC技术的发展，资本密集与技术密集的产业特性越来越突出，IDM企业越来越难以承受多领域研发和生产线升级带来的压力，朝更为专业化技术领域转变，同时将制造、封装测试等产能外包出去的意愿增强，促进了晶圆代工、专业化封装测试产业的崛起，而制造和封装测试环节分化独立出来，使专业设计厂商得以快速发展，垂直分工的产业组织模式确立。

集成电路行业模式演进图



目前，内地从事集成电路封装测试业务的企业主要分两类，一类是国际IDM公司设立的全资或控股的封装测试厂，另一类是专业从事封装测试的企业，二者的经营模式有显著差异。IDM设立的封装测试厂只是作为集团的一个生产环节，其产品主要返销回母公司，实行内部结算；而专业的集成电路封装测试企业则独立对外经营，采用客供料进料加工经营模式，接受集成电路芯片设计或制造企业的订单，为其提供封装测试服务，按封装测试量收取加工费。目前，随着全球IC行业专业化分工的趋势不断加强，专业封装测试企业的市场份额将不断扩大。

## 6) 影响封装测试行业发展的因素

### ① 有利因素

#### a. 电路封装测试业产能向中国转移，国内集成电路行业配套日益完善

近年来，我国在初级劳动力、技术研发人才、土地、资本等生产要素成本方面的优势依然存在，加之在垂直化专业分工模式发展等因素驱动下，全球主要的IT跨国厂商均将其集成电路产业链中的封装测试环节转移至我国，带动了我国封装测试行业的高速发展。此外，随着笔记本电脑、数码相机和其他电子信息产品的生产基地也都大规模向中国转移，中国已经成为世界电子信息产品的生产基地。作为终端应用领域的上游行业，集成电路行业在我国沿海地区，尤其是长三角地区已经逐步形成了完整的生产和配套产业链，区域协作优势在全球范围内也日益突出明显。集成电路封装测试所需的引线框架、塑封料和键合丝等原材料的

国内供应商都已具规模，基本能够满足国内封装测试企业的需求，原材料价格容易保持稳定。因此，从中长期角度来看，全球集成电路封装测试产业向中国转移的趋势仍将持续，并将不断提高我国集成电路封装测试行业的整体水平，带动行业的快速增长。

#### **b. 进口替代的逐渐加强**

以前大量进口高端产品是因为国内自身高端产品生产能力有限，难以从国内下游市场增长中受益（国内下游需求增长以高端为主）。作为计算机系统最核心部件，自主可控服务器 CPU 是国家安全的保障。我国自主产品的缺失会对国防、信息安全、金融、航天航空、远洋等重要工程的安全带来隐患。CPU 既是安全的奠基石，也是服务器软硬件中其它领域创新的保障和催化剂，它可以有效地带动整个芯片行业和服务器行业的发展。目前，中国自主生产 CPU 的市场占有率虽然不到 1%，但随着国内半导体产业结构逐渐向高端发展，我国半导体产品的自给率在逐年提升，国内企业因此能更多地从国内需求增长中受益。

#### **c. 国家产业政策的大力支持**

基于集成电路对于国民经济和国家安全的高度重要性，政府对集成电路产业的发展给予了一贯的高度关注，并先后采取了多项优惠政策及措施，这些政策促进了国内电子信息产业及集成电路产业的快速发展。根据国家发展规划，预期未来国家还将出台更多针对集成电路产业的优惠政策，这将有力推动我国集成电路产业的健康稳步发展。

#### **d. 行业技术水平不断提高**

为了适应电子产品多功能、小型化、便携性等需要，新的封装技术不断涌现，并推动了整个半导体封装测试行业的发展。半导体封装测试厂商通过加大技术投入，引进先进的生产设备，不断提高产品的技术含量，开发新型产品，从而可以保持较高的利润率水平，获得优势地位；同时，技术含量的提升，也提高了行业进入门槛，避免了行业内的恶性竞争，保障行业的健康发展。

#### **e. 集成电路市场前景广阔**

近年来我国集成电路产业持续繁荣发展，已成为全球半导体制造增速最快的

市场。在以3G/4G为代表的网络通信市场和以多媒体化为代表的数字消费市场日益增长的需求驱动下，我国集成电路产业将继续保持较快的发展速度，进而拉动我国集成电路封装行业的发展。

## ② 不利因素

### a. 同业竞争激烈

近年来，封装测试产业呈现强者更强的局面。封装测试产业技术发展迅速，需要投入大量资金来进行工艺技术的研究和开发，而行业内的强者拥有庞大的产能来降低成本，有足够的利润来提高技术研发投入，最终形成更强的竞争力。从国内封装测试厂家的竞争格局看，外资封装测试企业在生产规模、技术水平等方面存在明显的优势，国内封装测试业市场竞争激烈。

### b. 国内技术水平与国际技术水平仍存在差距

目前，在半导体封装测试行业，高端技术和高端产品的市场份额仍然由行业国际巨头占据，如台湾日月光、美国Amkor、台湾矽品精密、新加坡星科金朋、台湾POWER TECH等世界五大封装企业。目前，内地厂商则仍然以中低端为主，高端产品未形成规模效应，发达国家在技术水平上占有优势。提升内地集成电路企业的实力，促进其技术升级是做强内地集成电路企业的必由之路。

## 2、主要产品及服务

AMD苏州主要从事半导体封装和测试业务，业务按照产品类型主要分为先进封装和测试服务两块。从终端用户市场看，目标公司业务主要为台式机、笔记本、服务器的CPU业务，显卡产品以及游戏机产品。从地域分布来看，标的公司的业务主要在中国、日本、美国、新加坡和欧洲等国家和地区。标的公司业务结构如下：

先进封装（Advanced Packaging）：AMD苏州目前主要的封装技术是PGA封装技术，BGA-stiffener封装技术，BGA-coreless封装技术等高端封装技术。AMD苏州的装配线能够实现顶尖的封装设计和制造，精准、快速地生产高质量的尖端产品；生产工艺能够提供成套的C4（可控塌陷芯片连接）装配服务，包

括激光开槽、芯片分割、芯片分选装置、贴片机、倒装芯片焊接、底部填充、球形贴装和光学检测。AMD苏州共有4条装配线：2条BGA封装线和2条PGA封装线，封装线的季度装配能力为8 Million Units。

测试（Test Services）：AMD苏州提供包括老化测试、自动化测试、系统测试、激光打标、品质保证系统级测试、外观检查等在内的服务，特别是在游戏机等电子设备的测试方面实力突出。AMD苏州共有58台sapphire测试仪，2台verigy测试仪等，季度测试能力为12 Million Units。

### **3、主要经营模式**

#### **（1）销售模式**

AMD苏州系AMD下属专门从事封装与测试业务的子公司，主要用于承接AMD内部的芯片封装与测试的业务，本次重组前，AMD系AMD苏州的唯一客户。

#### **（2）采购模式**

AMD苏州的采购模式为：由客户提出产品需求，AMD苏州根据客户订单量依次确定生产计划、采购清单及备料计划、采购计划，并通过与供应商签订采购合同或订单，确定交货时间，按照技术标准将芯片封装、测试后发送给客户或客户指定的采购商。

### **4、安全生产和环境保护情况**

#### **（1）安全生产情况**

AMD苏州建立了完善的安全生产管理制度，并严格按照制度进行安全生产检查，AMD苏州的安全管理人员、特殊设备操作人员、电工等公司员工均通过安全生产监督管理局等部门的考核或认证，同时AMD苏州已通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

报告期内，AMD苏州没有因为重大安全事故受到处罚的情形。

#### **（2）环境保护情况**

AMD 苏州各项生产工艺符合国家和地方环境保护相关法律法规，生产活动中产生的废水、废气均经过专业处理后进行排放，并已取得苏州工业园区环保局签发的《排放污染物许可证》。同时，AMD 苏州已通过 ISO14001 环境质量管理体系认证。

报告期内，AMD 苏州不存在受到环保部门重大行政处罚的情形，本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定。

## 5、质量控制情况

AMD 苏州建立了严格、完善、并能够持续改进的质量控制体系，80%的工程和制造员工接受过精益六西格玛培训。AMD 苏州一体化的制造系统，能够实现实时工艺控制、零错误材料管理以及自动配方，成品率超过 99.95%；同时，AMD 苏州已通过 ISO19001 产品质量管理体系认证。

报告期内，AMD 苏州未发生因为产品质量问题而受到质量技术监督部门处罚的情形，也未出现因产品质量问题与客户发生重大法律纠纷的情况。

### （五）员工情况

AMD 苏州共有 1030 余名员工，其中 580 多名为技术人员和工程师，70% 以上的工程师拥有学士及以上学位，8% 拥有博士学位，42% 的技术人员拥有大专及以上学历。

### （六）主要财务指标

根据由交易对方所聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，AMD 苏州最近两年主要财务数据（经审计）以及最近一期（未经审计）的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目/年度 | 2015 年 1-6 月<br>/2015 年 6 月末 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产  | 83,568.05                    | 91,372.83        | 52,508.73        |
| 资产总额  | 115,873.21                   | 121,649.06       | 84,492.94        |
| 流动负债  | 12,963.77                    | 18,883.32        | 20,995.89        |
| 负债总额  | 12,963.77                    | 18,883.32        | 23,795.89        |

|         |            |            |            |
|---------|------------|------------|------------|
| 所有者权益合计 | 102,909.44 | 102,765.74 | 60,697.05  |
| 营业收入    | 30,381.02  | 96,331.07  | 102,780.49 |
| 营业利润    | 3,462.26   | 7,034.92   | 6,389.11   |
| 利润总额    | 3,619.84   | 6,576.88   | 6,653.59   |
| 净利润     | 2,866.74   | 5,613.59   | 5,090.20   |

注：以上财务数据尚需经过通富微电聘请的具有证券从业资格的会计师事务所进行审计

### （七）重大资产收购

本预案披露前十二个月内，AMD 苏州未进行重大资产收购或出售。

### （八）未决诉讼、为关联方提供担保

截至本预案签署日，AMD 苏州不存在未决诉讼、为关联方提供担保的情况。

### （九）非经营性资金占用

2015 年 1 月 5 日，AMD 苏州（委托人）、美国银行有限公司上海分行（贷款人）、AMD 中国（借款人）三方共同签署了《委托贷款协议》，协议约定贷款人根据委托人的委托将委托人的自有资金以贷款的方式提供给借款人。该委托贷款的贷款金额为人民币 430,000,000 元，贷款期限从 2015 年 1 月 26 日至 2016 年 1 月 26 日，年利率为 3.92%。

根据通富微电与 AMD 于 2015 年 10 月 15 日签署的《股权购买协议》，AMD 将于交割日之前结束关联方与 AMD 苏州之间的非经营性资金占用。

### （十）主要资产、负债状况及对外担保情况

#### 1、AMD 苏州的资产情况

根据安永华明出具的审计报告，截至 2014 年 12 月 31 日，AMD 苏州的总资产为 121,649.06 万元，其中流动资产为 91,372.81 万元，占比 75.11%，非流动资产为 30,276.25 万元，占比 24.89%。具体组成如下：

单位：万元

| 项目   | 账面值       | 占比     |
|------|-----------|--------|
| 货币资金 | 2,595.62  | 2.13%  |
| 应收账款 | 14,534.89 | 11.95% |
| 短期投资 | 49,024.75 | 40.30% |

|                |                   |                |
|----------------|-------------------|----------------|
| 其他应收款          | 15,625.87         | 12.85%         |
| 存货             | 9,458.33          | 7.78%          |
| 待摊费用           | 133.35            | 0.11%          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>91,372.81</b>  | <b>75.11%</b>  |
| 固定资产净额         | 26,423.60         | 21.72%         |
| 在建工程           | 2,919.17          | 2.40%          |
| 无形资产           | 933.48            | 0.77%          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>30,276.25</b>  | <b>24.89%</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>121,649.06</b> | <b>100.00%</b> |

AMD 苏州的流动资产主要包括应收账款、短期投资以及其他应收款。由于 AMD 苏州的产品均在 AMD 内部形成销售，因此应收账款均为应收最终控制方 AMD 的款项。

短期投资为 AMD 苏州存入资金池的资金。2012 年 8 月，AMD 苏州与国内关联公司以及美国银行有限公司签订了现金管理协议，AMD 苏州根据资金需求从主账户中存入资金或借出资金，视资金要求随借随还，无抵押及担保，年利率 0.35%。该资金池中 AMD 苏州公司的信用额度是人民币 5,000 万元。截至本预案签署日，AMD 苏州已与美国银行有限公司签订退出证书，退出上述资金池。

其他应收款主要包括员工备用金以及押金。

## 2、AMD 苏州的负债情况

根据安永华明出具的审计报告，截至 2014 年 12 月 31 日，AMD 苏州的总负债为人民币 18,883.32 万元，其中流动负债为人民币 18,883.32 万元，占比 100%。具体组成如下：

单位：万元

| 项目             | 账面值              | 占比             |
|----------------|------------------|----------------|
| 应付账款           | 15,763.58        | 83.48%         |
| 应付工资           | 183.60           | 0.97%          |
| 应交税金           | -484.96          | -2.57%         |
| 其他应付款          | 1,824.32         | 9.66%          |
| 预提费用           | 1,596.78         | 8.46%          |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>18,883.32</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>-</b>         | <b>0.00%</b>   |
| <b>负债合计</b>    | <b>18,883.32</b> | <b>100.00%</b> |

AMD 苏州的主要负债为应付供应商的货款。

### 3、对外担保状况

截至本预案签署日，AMD 苏州不涉及资产抵押或者对外担保事项。

### 4、不存在妨碍权属转移的情况

截至本预案签署日，AMD 苏州不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在其他妨碍权属转移的情况。

#### （十一）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关估值或评估情况

截至本预案签署日，AMD 苏州最近三年不存在股权交易、增资及改制相关的估值或评估情况。

#### （十二）预估值、账面净值、预估增值率及拟定价

标的资产的预估值、账面净值、预估增值率详见“第五节 标的资产预估作价及定价公允性 之一、标的资产预估作价情况”。

## 二、AMD 槟城基本情况

### （一）基本信息

|      |  |
|------|--|
| 名称   | ADVANCED MICRO DEVICES EXPORT SDN.BERHAD                             |
| 营业地址 | Phase III, Free Industrial Zone, Bayan Lepas, 11900 Penang, Malaysia |
| 注册号  | 40990-W  |
| 董事   | Huang Peter, Devinder Kumar A/L Oom Parkash, Neoh Soon Ee            |
| 注册资本 | 1,570,000 马来西亚林吉特  |
| 设立日期 | 1978 年 8 月 3 日   |
| 主营业务 | 半导体集成电路的封装与测试  |

### （二）历史沿革

#### 1、1978 年 8 月，AMD 槟城设立

AMD 槟城成立于 1978 年 8 月，成立时的名称为 ADVANCED MICRO DEVICES EXPORT SDN. BERHAD，股本总额为 2 马来西亚林吉特，股东及持股情况为：

| 序号 | 股东姓名或名称                | 持股金额（马来西亚林吉特） |
|----|------------------------|---------------|
| 1  | Raju Jayaraman Kerpaya | 1             |
| 2  | Charles Chye Lee       | 1             |
|    | 合计                     | 2             |

## 2、1979年3月，AMD 槟城股东变更

1979年3月，Raju Jayaraman Kerpaya 以及 Charles Chye Lee 分别将所持股份转让至 Advanced Micro Devices Sdn.Berhad 名下，同时 Advanced Micro Devices Sdn.Berhad 对 AMD 槟城增资 249,998 马来西亚林吉特，AMD 槟城的股本总额变更为 250,000 马来西亚林吉特，股东及持股情况变更为：

| 序号 | 股东姓名或名称                           | 持股金额（马来西亚林吉特） |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 1  | Advanced Micro Devices Sdn.Berhad | 250,000       |
|    | 合计                                | 250,000       |

## 3、1987年3月，AMD 槟城股东变更

1987年3月，Advanced Micro Devices Sdn.Berhad 对 AMD 槟城增资 1,000,000 马来西亚林吉特，AMD 槟城的股本总额变更为 1,250,000 马来西亚林吉特，股东及持股情况变更为：

| 序号 | 股东姓名或名称                           | 持股金额（马来西亚林吉特） |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 1  | Advanced Micro Devices Sdn.Berhad | 1,250,000     |
|    | 合计                                | 1,250,000     |

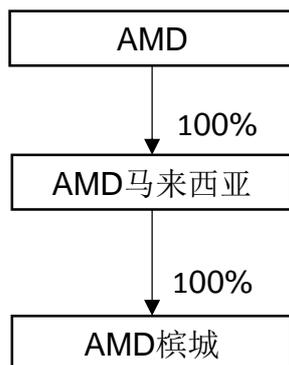
## 4、1994年11月，AMD 槟城股东变更

1994年11月，Advanced Micro Devices Sdn.Berhad 对 AMD 槟城增资 320,000 马来西亚林吉特，AMD 槟城的股本总额变更为 1,570,000 马来西亚林吉特，股东及持股情况变更为：

| 序号 | 股东姓名或名称                           | 持股金额（马来西亚林吉特） |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 1  | Advanced Micro Devices Sdn.Berhad | 1,570,000     |
|    | 合计                                | 1,570,000     |

### （三）产权控制结构

截至本预案出具之日，标的公司的产权控制结构如下：



#### （四）主营业务情况

##### 1、主营业务所处行业及概况

AMD 槟城主要从事集成电路封装测试业务，可以满足从处理器半成品切割、组装、测试、打标、封装的五大 CPU 后期制造流程，使其同时具备对中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）以及加速处理器（APU）进行封装和测试的能力。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），AMD 槟城的主营业务属于计算机、通信和其他电子设备制造业。而 AMD 槟城从事的集成电路封装测试业务属于半导体集成电路制造业的一个细分产业。

主营业务所处行业及概况详见“第四节交易标的基本情况”之“一、AMD 苏州基本情况”之“（四）主营业务情况”之“1、主营业务所处行业及概况”。

##### 2、主要产品及服务

AMD 槟城主要从事半导体封装和测试业务，业务按照产品类型主要分为先进封装和测试服务两块。从终端用户市场看，目标公司业务主要为台式机、笔记本、服务器的 CPU 业务，显卡产品以及游戏机产品。从地域分布来看，标的公司的业务主要在中国、日本、美国、新加坡和欧洲等国家和地区。标的公司业务结构如下：

**先进封装（Advanced Packaging）：**AMD 槟城目前主要的封装技术是 PGA 封装技术、BGA-stiffener 封装技术、BGA-coreless 封装技术、LGA-coreless 封装技术以及 MCM 技术等高端封装技术。AMD 槟城的装配线能够实现顶尖的封装设计和制造，精准、快速地生产高质量的尖端产品；生产工艺能够提供成套的 C4（可控塌陷芯片连接）装配服务，包括激光开槽、芯片分割、芯片分选装置、

贴片机、倒装芯片焊接、底部填充、球型贴装和光学检测。AMD 槟城共有6条装配线，封装线的季度装配能力为8.3 Million Units。

测试（Test Services）：AMD 槟城提供包括老化测试、自动化测试、系统测试、激光打标、品质保证系统级测试、外观检查等在内的服务，特别是在游戏机等电子设备的测试方面实力突出。AMD 槟城拥有43台蓝宝石测试仪，37台HST和38台kSLT等，季度测试能力为9 Million Units。

### **3、主要经营模式**

#### **（1）销售模式**

AMD 槟城系AMD 下属专门从事封装与测试业务的子公司，主要用于承接AMD 内部的芯片封装与测试的业务，本次重组前，AMD 系AMD 槟城的唯一客户。

#### **（2）采购模式**

AMD 槟城的采购模式为：由客户提出产品需求，AMD 槟城根据客户订单量依次确定生产计划、采购清单及备料计划、采购计划，并通过与供应商签订采购合同或订单，确定交货时间，按照技术标准将芯片封装、测试后发送给客户或客户指定的采购商。

### **4、安全生产和环境保护情况**

#### **（1）安全生产情况**

AMD 槟城建立了完善的安全生产管理制度，并严格按照制度进行安全生产检查，AMD 槟城满足当地政府机关与生产安全的相关法律法规并取得了相应证书，同时 AMD 槟城已通过 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。

报告期内，AMD 槟城没有因为重大安全事故受到的处罚的情形。

#### **（2）环境保护情况**

AMD 槟城各项生产工艺符合所在国环境保护相关法律法规，并获得了所在国环境保护部门签发的相关证书。同时，AMD 槟城已通过 ISO14001 环境质量

管理体系认证。

报告期内，AMD 槟城不存在受到所在国环保部门重大行政处罚的情形。

## 5、质量控制情况

AMD 槟城建立了严格、完善、并能够持续改进的质量控制体系，80%的工程和制造员工接受过精益六西格玛培训。同时一体化的制造系统，能够实现实时工艺控制、零错误材料管理以及自动配方，成品率超过 99.95%；同时，AMD 槟城已通过 ISO19001 产品质量管理体系认证。

AMD 槟城与 AMD 苏州之间采用同样的标准化方法，以及精确匹配的工具。报告期内，AMD 槟城未发生因为产品质量问题而受到所在国质监部门处罚的情形，也未出现因产品质量问题与客户发生重大法律纠纷的情况。

### （五）员工情况

AMD 槟城共有 870 余名员工，其中约 470 名为技术人员和工程师，工程师全部拥有学士及以上学位，2% 拥有硕士学位，全部的技术人员拥有大专及以上学历。

### （六）主要财务指标

根据 Ernst & Young 出具审计报告，AMD 槟城最近两年主要财务数据（经审计）以及最近一期（未经审计）的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目/年度   | 2015 年 1-6 月<br>/2015 年 6 月末 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产    | 73,710.93                    | 67,265.71        | 68,564.04        |
| 资产总额    | 101,411.83                   | 96,928.46        | 104,757.23       |
| 流动负债    | 33,091.04                    | 29,398.67        | 39,749.93        |
| 负债总额    | 33,091.04                    | 29,398.67        | 39,749.93        |
| 所有者权益合计 | 68,320.79                    | 67,529.79        | 65,007.30        |
| 营业收入    | 59,568.28                    | 157,157.99       | 161,582.05       |
| 营业利润    | 5,648.15                     | 6,034.66         | 6,778.10         |
| 税前利润    | 5,635.83                     | 6,024.61         | 6,764.06         |
| 税后利润    | 5,369.93                     | 5,478.10         | 7,565.61         |

注：以上财务数据尚需经过通富微电聘请的具有证券从业资格的会计师事务所进行审计；

以上科目当期金额按当期期末马来西亚林吉特对人民币汇率中间价计算。

### **(七) 会计政策与中国会计准则差异说明**

根据 Advanced Micro Devices Export Sdn. Bhd. (以下简称“AMD 公司”)对外公布的年度报表,截至 2013 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日止的财务报表是根据马来西亚会计准则局颁布的私有企业报告准则 (Malaysian Accounting Standards Board issued Private Entity Reporting Standards) 和马来西亚公司法 (Companies Act 1965 in Malaysia) 编制的。

安永会计师事务所马来西亚成员所槟城分所对 AMD 公司截至 2013 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日止的财务报表进行了审计,并分别于 2014 年 6 月 10 日和 2015 年 5 月 19 日出具了无保留意见的审计报告。

本公司管理层参考马来西亚私有企业报告准则及中国企业会计准则,针对 AMD 公司的会计政策和中国企业会计准则相关规定的差异进行了汇总和分析。针对相关的差异及其对 AMD 公司如果按中国企业会计准则编制财务报表的可能影响,本公司编制了 AMD 公司截至 2013 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日止财务报表时采用的会计政策与中国企业会计准则相关规定之间差异情况表及差异说明 (以下简称“差异情况表及说明”),并聘请致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 对该差异情况表及说明进行了鉴证并出具了《关于 Advanced Micro Devices Export Sdn. Bhd. 财务报表编制差异情况及差异说明的鉴证报告》(致同专字(2015)第 110ZC3312 号),报告主要内容如下:

“我们接受委托,对后附由南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“南通富士通公司”)管理层提供的 Advanced Micro Devices Export Sdn. Bhd. (以下简称“AMD 公司”)截至 2013 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日止按照马来西亚会计准则局颁布的私有企业报告准则 (Malaysian Accounting Standards Board issued Private Entity Reporting Standards) 和马来西亚公司法 (Companies Act 1965 in Malaysia) 编制财务报表所采用的会计政策 (以下简称“AMD 会计政策”)与财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定 (统称“中国企业会计准则”)的相关规定之间的差异情况表及差异说明(以下简称“差异情况表及说明”)执行了有限保证的鉴证工作。

根据中国证券监督管理委员会关于信息披露的相关要求，编制 AMD 公司会计政策与中国企业会计准则相关规定之间的差异情况表及说明是南通富士通公司董事会的责任。该等责任包括获得对 AMD 公司会计政策的详细理解，将这些会计政策和中国企业会计准则相关规定进行比较，对 AMD 公司若被要求采用中国企业会计准则相关规定而对其财务报表潜在的影响作出定性评估等。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对差异情况表及说明发表意见，并按照双方同意的业务约定条款，仅对南通富士通公司董事会报告我们的意见，除此之外并无其他目的，我们不会就本报告的内容向任何其他方承担责任或义务。

我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以就我们是否注意到任何事项使我们相信差异情况表及说明是否不存在重大错报获取有限保证。

相比合理保证鉴证业务，有限保证鉴证业务的收集证据程序更为有限，因而获得的保证程度要低于合理保证的鉴证业务。选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断，包括对差异情况表及说明是否存在重大错报风险的评估。我们的鉴证工作仅限于查阅 AMD 公司财务报表中披露的会计政策，复核差异情况表及说明的编制基础。

基于我们执行的有限保证鉴证工作，我们没有注意到任何事项使我们相信差异情况表及说明存在未能在所有重大方面反映 AMD 公司会计政策和中国企业会计准则相关规定之间的差异情况。

本鉴证报告仅供南通富士通公司董事会在实施对 AMD 公司收购计划时更好地了解 AMD 公司会计政策与中国企业会计准则相关规定之间的差异状况之用，本鉴证报告应当与 AMD 公司截至 2013 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日止经审计的财务报告(英文版)一并阅读。”

若 AMD 公司按中国企业会计准则相关规定编制财务报表的可能影响参见以下差异情况表：

| 项目      | Advanced Micro Devices Export Sdn. Bhd.主要会计政策  | 相关的中国企业会计准则  | 差异                                      |
|---------|--|--|---|
| 会计计量    | 财务报表均以历史成本为计量原则编制。   | 《企业会计准则基本准则》第四十三条规定：企业在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本计量，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。  | 无重大差异                                   |
| 列报金额单位  | AMD 公司以马来西亚货币千林吉特币为单位作为列报货币。   | 《企业会计准则第 30 号财务报表列报》第九条规定：企业应当在财务报表的显著位置披露人民币金额单位。   | 中国会计报表通常以“人民币元”为列报单位；马来西亚以“千林吉特币”为列报单位。 |
| 利润表的列报  | AMD 公司关于费用的列报，按照功能和性质列示。   | 《企业会计准则第 30 号财务报表列报》第三十条规定：企业在利润表中应当对费用按照功能分类，分为从事经营业务发生的成本、管理费用、销售费用和财务费用等。   | 无重大差异                                   |
| 固定资产及折旧 | <p>固定资产以成本减除累计折旧及减值准备后的金额列示。</p> <p>AMD 公司将采购金额超过 5,000 美元或等额林吉特计入固定资产。若采购金额小于 5,000 美元，直接费用化计入损益表。折旧以成本扣除残值，按照预计的使用年限直线法进行摊销。</p> <p>租入土地按照租赁年限直线法进行摊销。</p> <p>固定资产处置时，处置金额与固定资产账</p> | <p>《企业会计准则第 4 号固定资产》第八条规定：外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。</p> <p>《企业会计准则第 4 号固定资产》第六条规定：与固定资产有关的后续支出，符合本准则第四条规定的确认条件的，应当计入固定资产成本；不符合本准则第四条规定的确认条件的，应当在发生时计入当期损益。</p> <p>《企业会计准则第 4 号固定资产》第十四条规定：企业</p> | 除土地使用权在资产负债表中的列示不同外，无其他差异               |

| 项目              | Advanced Micro Devices Export Sdn. Bhd.主要会计政策   | 相关的中国企业会计准则  | 差异           |
|-----------------|---|--|--------------|
|                 | <p>面价值之差计入当期损益。</p> <p>AMD 公司将租入的土地计入固定资产在资产负债表中进行列示。</p>   | <p>应当对所有固定资产计提折旧。但是，已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外。</p> <p>《企业会计准则第 6 号无形资产》第十七条规定：使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额应当在使用寿命内系统合理摊销。</p> <p>《企业会计准则讲解》无形资产通常包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。</p> |              |
| <p>现金和现金等价物</p> | <p>出于现金流量表列报目的，现金及现金等价物包括：库存现金、即期交付的存于金融机构的银行存款、企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资、银行透支净额。</p> | <p>《企业会计准则第 31 号——现金流量表》第二条规定：现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。</p> <p>《企业会计准则讲解 2010》第三十二章第一节第二段（二）规定：“期限短”，一般是指从购买日起三个月内到期。</p>        | <p>无重大差异</p> |
| <p>租赁</p>       | <p>租赁资产若实质上转移了与资产所有权相关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。</p> <p>融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁</p>       | <p>《企业会计准则第 21 号租赁》第五条规定：融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。</p> <p>《企业会计准则第 21 号租赁》第十一条规定：在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值</p>                                   | <p>无重大差异</p> |

| 项目 | Advanced Micro Devices Export Sdn. Bhd.主要会计政策   | 相关的中国企业会计准则  | 差异 |
|----|---|--|----|
|    | <p>资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。相应的负债记录在资产负债表的借款中。在计算最低租赁付款额现值时，折现率采用租赁合同约定的利息率。若没有，则采用公司的增量借款利率。</p> <p>融资租赁付款额分为融资费用和应付的融资租赁款的减少两部分进行确认。</p> <p>将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值的差额作为非确认融资费用，在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。</p> <p>折旧政策应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧</p> <p>经营租赁中的租金，在租赁期内各个期间按照直线法分摊并计入当期损益。</p> | <p>与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。</p> <p>《企业会计准则第 21 号租赁》第十二条规定：承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。</p> <p>《企业会计准则第 21 号租赁》第十五条规定：未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。</p> <p>《企业会计准则第 21 号租赁》第十六条规定：承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。</p> <p>《企业会计准则第 21 号租赁》第二十二条规定：对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。</p> |    |

| 项目                 | Advanced Micro Devices Export Sdn. Bhd.主要会计政策   | 相关的中国企业会计准则   | 差异  |
|--------------------|---|---|---|
| <p><b>资产减值</b></p> | <p>于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，企业将比较账面价值和可回收金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。</p> <p>资产减值损失确认后，应及时确认在当期损益表，除非资产按重估价值进行计量。除资产的账面价值是以重估值计量的情况外，资产减值损失作为一项费用列示于利润表中。重估资产的减值损失，以同一资产前期确认的重估溢价为限，减少重估溢价。当该项资产减值迹象不存在或者减轻的情况下，可以冲回以前年度确认的减值损失。</p> | <p>《企业会计准则第 8 号资产减值》第四条规定：企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。</p> <p>《企业会计准则第 8 号资产减值》第六条规定：可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。</p> <p>《企业会计准则第 8 号资产减值》第十五条规定：资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。</p> <p>《企业会计准则第 8 号资产减值》第十七条规定：资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。</p> | <p>对以前年度确认的资产减值损失，中国企业会计准则规定不得转回。AMD 公司会计政策可以转回</p> |
| <p><b>政府补助</b></p> | <p>若企业收到的政府补助用于购买厂房和机器设备，满足政府补助协议规定的要求时，资产的入账价值以这些资产的价值扣</p>  | <p>政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政</p>   | <p>中国企业会计准则按照毛值列报，在受益期间进行摊销，AMD 公司按照扣除政府补助</p>      |

| 项目 | Advanced Micro Devices Export Sdn. Bhd.主要会计政策  | 相关的中国企业会计准则   | 差异                         |
|----|--|---|----------------------------|
|    | <p>除政府补助后的净值计量。收入的金额是政府补助扣除对应资产的折旧费用后的净额确认。</p> <p>若企业收到的政府补助用于费用化，将所产生的费用抵减政府补助后计入当期损益。</p> | <p>策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。</p> <p>与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。</p> <p>对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。</p> <p>与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。</p> <p>按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。</p> <p>已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额</p> | <p>后的净值列报，对净资产和净利润无影响。</p> |

| 项目 | Advanced Micro Devices Export Sdn.<br>Bhd.主要会计政策 | 相关的中国企业会计准则   | 差异 |
|----|--|---|----|
|    |  | <p>的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。</p> <p>中国企业会计准则规定，政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为“资本公积”处理的，属于资本性投入的性质，应当确认为资本公积。</p> |    |

## （八）重大资产收购

本预案披露前十二个月内，AMD 槟城未进行重大资产收购或出售。

## （九）未决诉讼

1999 年，建筑承包商 Hasjuara Sdn Bhd（以下简称“HSB”）起诉 AMD 槟城并追讨债务 153,000 美元，随后 AMD 槟城对其提起反向诉讼追讨向 HSB 债务 176,000 美元。2011 年，HSB 在该案终审前启动了结业程序。此后 HSB 未就该案联系过 AMD 槟城。

## （十）非经营性资金占用、为关联方提供担保

截至本预案签署日，AMD 槟城不存在非经营性资金占用以及为关联方提供担保的情形。

## （十一）主要资产、负债状况及对外担保

### 1、AMD 槟城的资产情况

根据 Ernst & Young 出具的审计报告，截至 2014 年 12 月 31 日，AMD 槟城的总资产为人民币 96,928.46 万元，其中流动资产为人民币 67,265.71 万元，占比 69.40%，非流动资产为人民币 29,662.75 万元，占比 30.60%。具体组成如下：

单位：万元

| 项目             | 账面值              | 占比             |
|----------------|------------------|----------------|
| 货币资金           | 6,032.19         | 6.22%          |
| 应收账款-关联方       | 513.01           | 0.53%          |
| 应收账款-控股公司      | 49,992.24        | 51.58%         |
| 其他应收款          | 1,427.97         | 1.47%          |
| 存货             | 9,300.30         | 9.60%          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>67,265.71</b> | <b>69.40%</b>  |
| 固定资产           | 28,165.68        | 29.06%         |
| 递延所得税          | 1,497.07         | 1.54%          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>29,662.75</b> | <b>30.60%</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>96,928.46</b> | <b>100.00%</b> |

注：以上科目当期金额按 2014 年 12 月 31 日马来西亚林吉特对人民币汇率中间价计算。

AMD 槟城的主要流动资产为对控股股东的应收账款，系由 AMD 槟城的产品均在 AMD 内部形成销售所致。关联方应收账款的账期一般在 30-90 天之间。

AMD 槟城的主要非流动资产为包括租赁的土地、厂房以及机械设备在内的固定资产，截至 2014 年 12 月 31 日，各项固定资产的账面净值分别为：

单位：万元

|      | 土地(租赁的)<br>以及厂房 | 工程制造设<br>备 | 其他设备及机<br>动车辆 | 待处理固<br>定资产 | 总额        |
|------|-----------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 账面净值 | 10,125.70       | 14,873.42  | 653.16        | 2,513.40    | 28,165.68 |

注：以上科目当期金额按 2014 年 12 月 31 日马来西亚林吉特对人民币汇率中间价计算。

## 2、AMD 槟城的负债情况

根据 Ernst & Young 出具的审计报告，截至 2014 年 12 月 31 日，AMD 槟城的总负债为人民币 29,398.67 万元，其中流动负债为人民币 29,398.67 万元，占比 100%。具体组成如下：

单位：万元

| 项目        | 账面值       | 占比      |
|-----------|-----------|---------|
| 应付账款      | 22,320.71 | 75.92%  |
| 其他应付款     | 6,814.40  | 23.18%  |
| 应付账款-控股公司 | 5.47      | 0.02%   |
| 应付账款-关联方  | 258.09    | 0.88%   |
| 流动负债合计    | 29,398.67 | 100.00% |
| 非流动负债合计   | -         | 0.00%   |
| 负债合计      | 29,398.67 | 100.00% |

注：以上科目当期金额按 2014 年 12 月 31 日马来西亚林吉特对人民币汇率中间价计算。

AMD 槟城的负债主要来源于对供应商的应付账款，供应商基于 AMD 槟城的账期一般为 30-90 天。

## 3、对外担保状况

截至本预案签署日，AMD 槟城不涉及资产抵押或者对外担保事项。

## 4、不存在妨碍权属转移的情况

截至本预案签署日，AMD 槟城不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在其他妨碍权属转移的情况。

## **（十二）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关估值或评估情况**

截至本预案签署日，AMD 槟城最近三年不存在股权交易、增资及改制相关的估值或评估情况。

## **（十三）预估值、账面净值、预估增值率及拟定价**

标的资产的预估值、账面净值、预估增值率详见“第五节 标的资产预估作价及定价公允性 之一、标的资产预估作价情况”。

## 第五节 交易标的估值

### 一、交易标的预估值

标的公司截至预估值基准日未经审计的账面净资产为 28,008.09 万美元，标的公司股东全部权益预估值为 57,629 万美元，较预估值基准日账面净资产的预估增值 29,620.91 万美元，增值率为 105.76%。

### 二、预估方法说明

本次预估值的目的是确定标的公司于预估值基准日的投资价值。估值机构在综合考虑本次预估值所采用的价值类型、估值对象特性以及影响估值对象未来盈利水平等重要因素的基础上，采用现金流量折现法和上市公司比较法作为本次预估的估值方法，最终采用现金流量折现法的测算结果作为本次预估结论。

现金流量折现法通常细分企业自由现金流和股权自由现金流折现模型。本次现金流量折现法估值选用企业自由现金流折现模型。

市场法是将估值对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定估值对象价值的一种估值方法，细分上市公司比较法和交易案例比较法两种具体形式。上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算适当的价值比率，在与估值对象比较分析的基础上，确定估值对象价值的一种具体方法。市场法的具体应用需要具有充分活跃的资本市场，可比公司与估值对象具有相应的可比价值比率，且此价值比率及对应的技术参数等能够获取及量化。

IC 封测行业为正处上升发展趋势的行业，对先进生产设备的依赖性较强，整个行业具有重资产、周期性较强的特点。因此，本次预估采用调整后 P/B 指标（P/TBV）作为市场法中的可比价值比率。

本次交易行为完成后，AMD 将继续采用成本加成等方式采购标的公司的主要产品，上市公司未来也有将其部分产品投入标的公司利用标的公司剩余产能进行生产的意愿，而 AMD 未来也有可能采购上市公司现有的部分产品。即交易行为完成后，上市公司将以标的公司为平台，实现与 AMD 在技术、部分业务范畴

的合作与融合。因本次交易行为中，上市公司与 AMD 签署了一系列对标的公司未来盈利能力产生直接和重要影响的相应条款。此部分条款大大降低了标的公司与同业上市公司之间盈利、资产层面定价的可比性。因此，本次预估值通过现金流折现的形式，对标的公司延续现有盈利模式下所体现的价值量及本次交易所形成的价值增量进行量化。本次估值最终选用现金流量折现法测算结果作为最终估值结论。

### 三、预估作价合理性分析

本次预估值本着独立、客观、公正的原则，遵循通用的估值思路及相应的参数选取方法，并综合考虑了市场对相似资产的定价水平，以及本次交易行为实施后影响标的公司盈利能力的相关因素。本次预估所选用的估值方法合理，预估值结论客观、公允。

截至预估基准日，标的公司未经审计的账面净资产值为 28,008.09 万美元，标的公司股东全部权益预估值为 57,629 万美元，较基准日账面净资产的预估增值 29,620.91 万美元，增值率为 105.76%。标的公司预估值在合理且公允的区间之内，反映了估值对象的潜在投资价值，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

账面净资产以符合会计准则为前提，主要以历史成本为核算依据，反映各项资产、负债的历史成本，对某些直接影响企业盈利能力的知识产权类资产，无法通过财务账面充分反映其真实价值。此外，标的公司采用较为激进的固定资产折旧处理方式，其固定资产的折旧年限短于国内同行业上市公司所使用的相应标准，导致其账面净资产价值的大幅低估。

AMD 在 IC 封测行业拥有丰富的经营管理经验、技术资源及品牌优势，在全球拥有稳定的客户基础及广泛的销售渠道，在业内形成了良好的口碑，掌握了多项 IC 封测行业的核心技术，是业内全球领先的企业。以上品牌、销售渠道、技术、人力资源等无形资产的价值并未在财务账面予以充分体现。本次预估值结论基于标的公司潜在投资价值的考虑，将影响标的公司未来盈利能力的多项因素，以及标的公司现有的有形资产、无形资产在投资价值类型下进行了量化。因此，

标的公司预估值结论高于其账面净资产值。

## 第六节 本次交易对上市公司的影响

### 一、本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，公司主营业务为集成电路的封装和测试。通过本次交易，公司将引入标的公司在技术、国际化和系统化管理方面的优势和经验，整合双方的资源，发挥协同效应，提高在封装测试领域的核心竞争力，进一步增强公司的主营业务能力和盈利能力。本次交易不会对上市公司的业务范围产生影响。

#### （一）技术协同

标的公司掌握并应用 PGA 封装技术、BGA-stiffener 封装技术、BGA-coreless 封装技术以及 LGA-coreless 封装技术等世界主流先进封装技术，终端应用领域主要为 PC 机和服务器的 CPU、显卡产品以及游戏机产品。

目前上市公司正在积极拓展其先进封装市场，并且已经具备了一定的技术基础。本次收购能够丰富公司先进封装的技术水平与服务能力，拓展其终端应用领域，延伸其产品线，为客户提供综合服务解决方案。

#### （二）市场协同

上市公司产品目前主要出口国外，主要销售区域为美国、欧盟和日本、韩国及台湾等地区。标的公司产品的终端客户市场主要在中国、日本、美国、新加坡和欧洲等国家和地区。本次收购完成后，上市公司将在巩固标的公司现有的销售区域、市场份额的基础上，进一步开拓高端客户在先进封装与测试领域的需求。未来，标的公司将在成本可控的前提下进行稳健扩张。

#### （三）品牌协同

超威半导体作为世界领先的半导体芯片提供商，在全球市场享有相当的市场声誉和地位，形成了显著的品牌优势。本次收购完成后，上市公司将调整生产布局，将标的公司先进技术、品牌与国内以及槟城生产的成本优势整合，发挥品牌协同优势。

## 二、本次交易对上市公司盈利能力的影响

截至 2015 年 6 月末，AMD 苏州实现营业收入 30,381.02 万元，净利润 2,866.74 万元。按照 2015 年 6 月 30 日马来西亚林吉特对人民币汇率中间价计算，截至 2015 年 6 月末，AMD 槟城实现营业收入 59,568.28 万元，净利润 5,369.93 万元，AMD 苏州与 AMD 槟城营业收入合计 89,949.30 万元、净利润 8,236.67 万元（以上数据均未经审计）。截至 2015 年 6 月末，上市公司实现营业收入 111,015.51 万元、净利润 8412.52 万元。本次交易完成后，将有利于上市公司提高盈利能力。AMD 苏州与 AMD 槟城合并财务信息如下表所示：

单位：万元

|         | 2015 年 1-6 月/<br>2015 年 6 月末 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产    | 157,278.98                   | 158,638.54       | 121,072.77       |
| 资产总额    | 217,285.04                   | 218,577.52       | 189,250.17       |
| 流动负债    | 46,054.81                    | 48,281.99        | 60,745.82        |
| 负债总额    | 46,054.81                    | 48,281.99        | 63,545.82        |
| 所有者权益合计 | 171,230.23                   | 170,295.53       | 125,704.35       |
| 营业收入    | 89,949.30                    | 253,489.06       | 264,366.14       |
| 营业利润    | 9,110.41                     | 13,069.58        | 13,160.01        |
| 税后利润    | 8,236.67                     | 11,091.69        | 12,655.81        |

目前，受全球封测产能向中国转移，国内封测技术突破，国内半导体设备国产化需求上升和下游消费电子设备需求的增长以及国家颁布了多项政策积极鼓励和发展半导体封装环节等因素驱动，中国封测行业在半导体行业紧缩周期中逆势扩张，且公司自身具备较强的竞争力，因此本次交易完成后，上市公司的盈利能力将进一步增强。

由于与本次重组相关的审计、估值工作尚未最终完成，目前上市公司仅能根据现有的财务资料和业务资料，基于国家宏观经济基本面没有重大变化和公司经营情况、管理层没有重大变动的假设下，对本次交易完成后上市公司的财务状况和盈利能力进行初步分析。标的公司具体财务数据将以审计结果为准，上市公司将在相关审计、估值完成后再次召开董事会，对相关事项进行审议，并详细分析本次交易对公司盈利能力的影响，提醒投资者特别关注。

### 三、本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易为现金收购，不涉及发行股份，不影响公司的股本总额和股权结构。

### 四、本次交易对上市公司同业竞争和关联交易的影响

#### （一）本次交易对上市公司同业竞争的影响

在本次交易前，上市公司主要从事半导体封装测试业务，而公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事同类业务，因此，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

本次交易为现金收购，不涉及发行股份，交易完成后，上市公司与控股股东、实际控制人之间的控股权及实际控制关系没有发生变更。本次交易的标的公司亦从事半导体封装测试业务，上市公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未从事与标的公司形成同业竞争的业务。

因此，本次重大资产收购完成后，上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不会产生新的同业竞争。

#### （二）本次交易对上市公司关联交易的影响

本次交易的交易对方及其控股股东、实际控制人与本公司及本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

本次交易并未导致上市公司实际控制人变更。上市公司与实际控制人及其关联企业不会因为本次交易新增经常性的关联交易。本次交易完成后，上市公司严格执行上市公司关联交易制度。上市公司与控股股东、实际控制人及其关联企业之间的关联交易将继续严格按照公司《关联交易管理办法》和有关法律法规及《公司章程》的要求履行关联交易的决策程序。上市公司与关联方关联交易，将根据法律法规及上市公司内部治理准则的要求，履行有关关联交易的审批程序，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；切实履行信息披露的有关规定；不损害全体股东特别是中小股东的合法权益，维护上市公司及其股东的利益。

## 五、本次交易对公司治理的影响

本次交易前，上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至本预案签署日，上市公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求。

本次交易完成后，对上市公司的股权控制关系不产生影响，上市公司将按相关法律、法规和制度的要求进一步完善公司治理结构。

## 第七节 风险因素

### 一、本次交易有关的风险

#### （一）审批风险

本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：

1、待公司相关的审计、估值等工作完成后再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案；

2、公司股东大会审议通过本次交易；

3、国家发改委或其地方分支机构备案；

4、江苏省商务厅的备案；

5、公司注册地银行：根据《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发[2015]13号），公司需到注册地银行进行关于本次交易涉及的境内机构境外直接投资外汇登记（如适用）；

6、AMD 交付有关通过本次交易的内部决议文件；

7、AMD 取得苏州工业园区商务部门的批复；

8、AMD 取得马来西亚国际贸易及工业部的批复。

本次交易能否取得上述批准、通过审查或核准，及取得上述批准、核准、通过审查的时间存在不确定性。因此，重组方案的最终成功实施存在审批风险。

#### （二）国际化经营的风险

本次交易的标的公司之一 AMD 槟城为一家境外公司，其主要资产及业务均在境外，AMD 槟城与本公司在法律法规、会计税收制度、商业管理、公司管理制度、企业文化等经营管理环境方面均存在差异。

本次交易完成后，公司在标的公司人力资源、管理、运营、生产等方面的整合到位尚需一定时间，公司在培养国际化经营管理人才方面尚需一定投入。本次

交易后，公司和标的公司的经营管理能否达到预期存在一定的不确定性。

### **（三）商誉减值风险**

由于本次股权购买是非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。

本次股权购买完成后公司将会确认较大额度的商誉，若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的公司所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

### **（四）公司治理风险和整合风险**

本次交易前，上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深交所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度。本次交易完成后，公司将新增两家子公司，管理、协调和信息披露工作量及工作难度有所增加。上市公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构，维护上市公司及中小股东的利益。若上市公司不能加强合规管理，则可能面临公司治理失效的风险。

本次交易完成后，为发挥协同效应，上市公司和标的公司需在客户资源管理、市场营销、技术研发、财务核算、人力资源管理等方面进行一定程度的优化整合。但是，整合能否顺利实施存在一定的不确定性，整合可能无法达到预期效果，甚至可能会对标的公司乃至上市公司原有业务的运营产生不利影响，提请投资者注意收购整合风险。

### **（五）法律、政策风险**

本次交易涉及中国、美国、马来西亚、香港等地的法律与政策，公司为中国注册成立的上市公司，而标的公司之一位于马来西亚，交易对方位于美国，存在政府和相关监管机构出台不利于本次交易的相关法律、政策或展开调查行动的风险。

## **（六）战略投资者合作不确定的风险**

公司拟与包括产业基金在内的战略投资者共同出资对标的资产进行收购，目前，公司已就本次交易与产业基金初步达成共同投资意向，具体投资合作细节及相关商务条款还在具体协商讨论中，不排除最终无法达成合作的风险。

如上市公司与包括产业基金在内的战略投资者未就本次交易达成合作，上市公司将自筹资金完成本次交易。

## **（七）业绩目标与安排尚未签署的风险**

公司与交易对方就标的公司的业绩目标与安排的相关条款尚未签署，存在不确定性的风险。

# **二、交易标的有关风险**

## **（一）客户集中度高的风险**

本次收购前，AMD 苏州及 AMD 槟城系 AMD 下属专门从事封装与测试业务的子公司，主要用于承接 AMD 内部的芯片封装与测试的业务，本次重组前，AMD 系 AMD 苏州及 AMD 槟城的唯一客户。虽然本次交易后 AMD 苏州及 AMD 槟城将在上市公司以及 AMD 的支持下开拓除 AMD 之外的其他客户，但在短期内 AMD 苏州及 AMD 槟城的客户仍将以 AMD 为主。

若今后 AMD 经营状况出现较大变动，导致 AMD 的封装及测试需求量减少，则标的公司将由于客户集中度高而面临经营波动的风险。

## **（二）行业波动的风险**

上市公司及标的公司的业务情况和盈利能力受半导体行业的景气状况影响较大，而半导体行业具有周期性波动的特点。受全球金融危机的影响，2008年第四季度和2009年，半导体行业景气度直线下降，跌至谷底；2010年，开始强劲复苏，而我国集成电路市场增速领先于全球市场。2011年受欧债危机影响，半导体行业全年景气度呈现前高后低的走势，2012年延续2011年的低迷状态，行业整体在低谷徘徊。2013年景气度有所回升，2014年继续保持复苏态势。半导体行业在发展过程中的波动会对本公司及标的公司的经营业绩产生一定影响。上

市公司将会密切关注市场需求动向，加快技术创新步伐，及时进行产品结构与生产计划的调整，降低行业波动给公司带来的经营风险。

### **（三）标的资产的估值风险**

由于与本次交易相关的审计、估值等相关工作尚未完成，目前公司只能根据现有的财务和业务资料，在假设宏观环境和标的公司生产经营状况不发生重大变化的前提下，基于标的公司现有资产以及未来盈利状况所做出的初步价值量判断。本预案所引用的标的资产预估值可能与最终估值结果存在差异。在此提请投资者关注相关风险。

## **三、其他风险**

### **（一）外汇风险**

由于标的公司的日常运营中涉及美元、马来西亚林吉特等货币，而公司的合并报表记账本位币为人民币。人民币与其他货币之间汇率的不断变动，将可能给本次交易及公司未来运营带来汇兑风险。

### **（二）股票投资风险**

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。公司本次交易的相关部门审批工作，尚需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的投资风险。

### **（三）其他风险**

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

## 第八节 其他重大事项

### 一、保护中小投资者的措施

为保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，本次交易过程将采取以下安排和措施：

#### （一）严格履行上市公司信息披露的义务

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重组办法》、《关于规范上市公司资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规的要求对本次交易方案采取严格的保密措施，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本次预案披露后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。

#### （二）严格履行相关程序

公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。本次交易预案在提交董事会讨论时，独立董事就该事项发表了独立意见。本次交易标的将由具有证券业务资格的会计师事务所和估值机构分别进行审计、估值，确保拟收购资产的定价公允、公平、合理。待相关审计、估值工作完成后，上市公司将编制《重组报告书》再次提交董事会、股东大会讨论，独立董事将再次对本次交易的公允性发表独立意见，独立财务顾问和法律顾问将对本次交易出具独立财务顾问报告和法律意见书。

#### （三）网络投票安排

本公司董事会将在召开审议本次交易方案的股东大会前发布提示性公告，提醒全体股东参加审议本次交易方案的临时股东大会。公司将严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，在表决本次交易方案的股东大会中，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，充分保护中小股东行使投票权的权益。

#### （四）业绩目标与安排

经过初步协商，双方在股权转让协议的附件中，就标的公司的业绩目标和安排具体如下：

“AMD 承诺支持两家标的公司执行初始商业计划中有关 AMD 股东部分的业务，支持两家标的公司达成收入和利润目标（两家标的公司每个财政年度合计共 2,000 万美元利润，自本协议生效日起 36 个月内有效）。“利润”是指按美国通用会计准则计算、未扣息、税的与 AMD 有关的利润。如某一财政年度不是完整年度，则收入和利润目标应当按比例予以调整。收入和利润目标将合并考虑两家标的公司的财务业绩。如两家标的公司严重偏离事先同意的目标，双方应善意地尽最大努力共同协作，采取双方同意的措施来达到目标，包括增加 AMD 的采购量、调整公司的成本、调整 AMD 的采购价。在按照本协议约定尽最大努力的过程中，若双方任何一方采取或避免采取的任何措施将对其盈利能力或商业利益造成不利影响，则任何一方将无义务采取或避免采取该等措施。在计算是否达到利润目标时，标的公司获得的政府补贴不计算在内，除非该等政府补贴与交割日前安装在标的公司的运营设施直接相关或者与 AMD 产品或技术实质上关联，那么该等政府补贴的 50%可被计入利润目标。

在计算利润目标时，以下因素不予考虑：1、标的公司因重新对资产估值或改变折旧规定导致资产账面价值变化；2、标的公司向其他客户提供服务发生的费用；3、各方同意的标的公司的 AMD 业务商业计划未规定的费用；4、标的公司未能履行义务或向其他客户违约造成的责任、开支、费用或标的公司没有可用的产能、技术稳定性、质量或价格竞争力来提供服务。如标的公司实现利润超过预定目标的 10%，则超过 10%部分计入下一财政年度 AMD 的利润目标。AMD 有权聘请独立审计机构核实该条项下标的公司的财务指标。AMD 应提前 5 个工作日通知标的公司，且该类审计每六个月仅可进行一次。”

最终条款将在资产重组报告书中予以披露。

#### （五）其他保护投资者权益的措施

本公司已聘请具有证券业务资格的审计机构、估值机构对标的公司进行审

计、估值，已聘请独立财务顾问、财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价、标的公司的权属状况等情况进行核查，并将对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见。同时，公司独立董事将对估值定价的公允性发表独立意见，确保本次交易公允、公平、合法、合规，不损害上市公司股东利益。

## 二、独立董事的意见

公司独立董事对本次交易发表了以下独立意见：

1、本次重大资产重组的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。

2、公司本次重大资产重组不构成关联交易，公司第五届董事会第九次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次重大资产重组事项相关议案时履行了法定程序。

3、公司本次交易的方案、定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

4、公司聘请招商证券作为本次交易的估值机构。除业务关系外，估值机构及经办人员与公司、交易对方、标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。估值机构具有独立性。估值机构和估值人员所设定的估值假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。

5、本次重大资产重组有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。

6、同意公司与相关主体签署的《股权购买协议》以及本次董事会就本次重大资产重组事项的总体规划。待本次重组的相关其他工作完成后，公司就本次重组事项的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。

综上，本次重大资产重组的方案、定价原则等符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。

### 三、公司股票连续停牌前股票价格无异常波动的说明

因筹划重大资产重组事项，本公司股票于 2015 年 10 月 16 日起停牌。根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号文）的相关规定，本公司对公司股票连续停牌前 20 个交易日的股票价格波动情况，以及该期间中小板综指及行业指数波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：

| 日期                  | 通富微电股价<br>(元/股)<br>(002156.SZ) | 中小板综指<br>(399101.SZ) | 证监会-电子设备<br>(883136.WI) |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2015 年 10 月 15 日收盘价 | 15.50                          | 11,330.43            | 2,556.08                |
| 2015 年 8 月 6 日收盘价   | 15.64                          | 12,313.59            | 2,955.86                |
| 期间涨跌幅               | -0.90%                         | -7.98%               | -13.53%                 |

从上表可知，本公司股价在本次停牌前 20 个交易日内，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动均未超过 20%，不存在异常波动。

### 四、交易标的资金占用情况

2015 年 1 月 5 日，AMD 苏州（委托人）、美国银行有限公司上海分行（贷款人）、AMD 中国（借款人）三方共同签署了《委托贷款协议》，协议约定贷款人根据委托人的委托将委托人的自有资金以贷款的方式提供给借款人。该委托贷款的贷款金额为人民币 430,000,000 元，贷款期限从 2015 年 1 月 26 日至 2016 年 1 月 26 日，年利率为 3.92%。

根据通富微电与 AMD 于 2015 年 10 月 15 日签署的《股权购买协议》，AMD 将于交割日之前结束关联方与 AMD 苏州之间的非经营性资金占用。

### 五、关联方担保情形

本次交易完成后，上市公司不存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形。

## 六、最近十二个月重大资产交易情况

上市公司最近十二个月未发生重大资产交易。

## 七、关于不得参与重大资产重组情形的说明

本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

通富微电、交易对方、标的公司以及本次交易的各证券服务机构和相关经办人员，均不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条，即“因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任”而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

## 八、公司利润分配政策、相应的安排及董事会对前述情况的说明

上市公司重视对投资者的合理投资回报，《公司章程》第一百五十六条对公司利润分配政策、利润分配决策程序、利润分配政策调整和信息披露等事项进行了明确的规定，具体内容如下：

“第一百五十三条，公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年税后利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程另有规定的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配

税后利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配税后利润。

第一百五十四条，公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百五十六条 公司利润分配政策：

（一）利润分配政策的基本原则

公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

（二）利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（三）现金分红比例及条件

公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

- 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司未来十二个月内无拟进行收购资产、对外投资和投资项目（募集资金投资项目除外）的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

现金分红比例：

在满足现金分红条件时，最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的公司可供分配利润的 10%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### （四）现金分红间隔时间

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司应当进行年度利润分配。公司董事会可以根据公司盈利情况、资金需求状况、股本情况等提议进行中期利润分配。

（五）公司当年盈利，但管理层、董事会未提出现金分红预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、留存收益的用途和使用计划等事项，经独立董事发表意见后提交股东大会特别决议通过。

#### （六）发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

#### （七）利润分配的审议程序：

公司利润分配预案由公司经营层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求提出分红建议和预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，由独立董事对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。

#### （八）利润分配政策调整的决策机制与程序：

公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，该议案在提交股东大会批准时，公司同时应提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

（九）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

## 第九节 独立财务顾问的核查意见

招商证券作为通富微电的独立财务顾问，参照《证券法》、《公司法》、《重组办法》等法律法规的规定和中国证监会的要求，通过尽职调查和对《南通富士通微电子股份有限公司重大资产购买预案》等信息披露文件的审慎核查后认为：

1、通富微电本次交易方案符合《重组办法》、《规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件（2014 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定；

2、本次交易标的资产的定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；

3、本次拟购买的标的公司权属清晰；本次交易的实施将有利于提高上市公司资产质量和盈利能力、增强上市公司持续经营能力，符合上市公司及全体股东的利益；

4、预案符合法律、法规和证监会和深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

5、鉴于通富微电将在相关审计、估值工作完成后将再次召开董事会审议本次交易方案，届时本独立财务顾问将根据《重组办法》及相关业务准则，对本次重大资产购买方案出具独立财务顾问报告。

## 第十节 上市公司及全体董事声明

本公司及董事会全体成员保证《南通富士通微电子股份有限公司重大资产购买预案》内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本次重大资产购买之标的公司的审计、估值工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、估值机构的审计、估值，本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

全体董事签字：

石明达

石磊

高峰

夏鑫

曲渊景昌

福井明人

八重樫郁雄

陈贤

张卫

刘剑文

严晓建

（本页无正文，为《南通富士通微电子股份有限公司重大资产购买预案》之盖章页）

南通富士通微电子股份有限公司

2015年10月15日